

北京市君合律师事务所

关于

珠海越亚半导体股份有限公司

首次公开发行（A 股）股票并在创业板上市

之

法律意见书



二〇二五年九月

## 目 录

目 录.....	1
释 义.....	5
正 文.....	9
一、本次发行的批准和授权.....	9
二、本次发行的主体资格.....	10
三、本次发行的实质条件.....	11
四、发行人的设立.....	15
五、发行人的独立性.....	16
六、发起人和股东.....	16
七、发行人的股本及其演变.....	18
八、发行人的业务.....	21
九、关联交易及同业竞争.....	24
十、发行人的主要财产.....	25
十一、发行人的重大债权债务.....	29
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	29
十三、发行人公司章程的制定与修改.....	30
十四、发行人的股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	30
十五、发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化.....	31
十六、发行人的税务.....	32
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	33
十八、发行人募集资金的运用.....	34
十九、发行人业务发展目标.....	34
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....	35
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价.....	36
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题.....	36
二十三、本次发行的总体结论性意见.....	37

## 北京市君合律师事务所

### 关于珠海越亚半导体股份有限公司

# 首次公开发行（A股）股票并在创业板上市之 法律意见书

致：珠海越亚半导体股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”或“君合”）接受珠海越亚半导体股份有限公司（以下简称“越亚半导体”、“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人首次公开发行（A股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发注册管理办法》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《监管规则适用指引——法律类第2号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》（以下

北京总部	电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350	上海分所	电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5492	广州分所	电话: (86-20) 2805-9088 传真: (86-20) 2805-9099	深圳分所	电话: (86-755) 2939-5288 传真: (86-755) 2939-5289
杭州分所	电话: (86-571) 2689-8188 传真: (86-571) 2689-8199	成都分所	电话: (86-28) 6739-8000 传真: (86-28) 6739 8001	西安分所	电话: (86-29) 8550-9666	青岛分所	电话: (86-532) 6869-5000 传真: (86-532) 6869-5010
重庆分所	电话: (86-23) 8860-1188 传真: (86-23) 8860-1199	大连分所	电话: (86-411) 8250-7578 传真: (86-411) 8250-7579	海口分所	电话: (86-898)3633-3401 传真: (86-898)3633-3402	香港分所	电话: (852) 2167-0000 传真: (852) 2167-0050
纽约分所	电话: (1-737) 215-8491 传真: (1-737) 215-8491	硅谷分所	电话: (1-888) 886-8168 传真: (1-888) 808-2168	西雅图分所	电话: (1-425) 448-5090 传真: (1-888) 808-2168		www.junhe.com

简称《**执业细则**》)等有关规定编制和落实了查验计划,查阅了按规定需查阅的有关文件及本所律师认为出具本法律意见书需查阅的其他文件。同时,本所律师就有关事项向发行人的股东、董事、监事及高级管理人员做了询问并进行了必要讨论,并合理、充分运用了包括但不限于实地调查、当面访谈、书面审查、查询等方式进行查验,对有关事实进行了查证和确认。除前述文件、资料及说明的审查之外,本所律师还通过国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、中国审判流程信息公开网(<https://splcgk.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn/>)、中国市场监管行政处罚文书网(<http://cfws.samr.gov.cn/>)、中国证券投资基金业协会官方网站(<http://www.amac.org.cn/>)、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、深圳证券交易所网站(<https://www.szse.cn/index/index.html>)等公开渠道进行了必要的查验。

在前述调查过程中,本所及本所律师得到了发行人作出的如下书面保证:发行人已经提供了本所及本所律师出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函、证明或口头证言;提供给本所及本所律师的文件材料及其所述事实均是真实、准确、完整的,并无任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏之处;文件材料为副本或者复印件的,其与正本或原件完全一致和相符,文件上的签名和印章均是真实和有效的,各文件的正本及原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所及本所律师依赖政府有关部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件作出判断。

本所及本所律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》和《执业细则》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及本所律师仅就与本次发行有关的中国法律问题发表意见,且仅根据中国法律法规发表法律意见;对涉及中国境外机构及人士的有关事宜,均援引并依

赖于境外律师出具的法律意见。本所及本所律师不对有关会计、审计、验资、资产评估、投资决策等非法律专业事项发表意见，在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告、内部控制审计报告、纳税鉴证报告等专业报告中某些数据和结论引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所及本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所及本所律师不具备对该等非法律专业事项进行核查及发表评论意见的适当资格和能力，对此本所及本所律师依赖具备资质的专业机构的意见对该等专业问题作出判断。

本所同意发行人在其为本次发行所编制的《招股说明书》中，自行引用或按照深交所的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法定文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

## 释 义

本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，下列简称和术语具有以下含义：

简称/术语	释义
越亚半导体、公司、发行人	珠海越亚半导体股份有限公司，曾用名珠海越亚封装基板技术股份有限公司
本次发行、本次发行上市、IPO	发行人经同意注册后首次公开发行（A股）股票并在创业板上市的行为
报告期	发行人就申请本次发行而披露的会计报表报告期，即2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月
申报基准日	2025年6月30日
越亚有限	珠海越亚封装基板技术有限公司，系公司前身
南通越亚	南通越亚半导体有限公司，系发行人的全资子公司
珠海越芯	珠海越芯半导体有限公司，系发行人的全资子公司
香港越亚	越亚封装基板（香港）有限公司（英文名称：ACCESS Substrates HK Limited），香港注册公司，系发行人的全资子公司
美国越亚	ACCESS Technologies USA，美国注册公司，系发行人的全资子公司
方正信产	北大方正信息产业集团有限公司，曾用名方正信息产业控股有限公司
AMITEC 公司	Amitec Advanced Multilayer Interconnect Technologies Ltd.（中文名：AMITEC 多层互连技术有限公司）
新信产	方正信息产业有限责任公司
巨人网盛	深圳市巨人网盛投资咨询合伙企业（有限合伙）
华金领瑞	珠海华金领瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）
东方富海管理	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）
深圳鑫富	深圳市鑫富远泰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名遵义鑫悦企业管理合伙企业（有限合伙）、萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业（有限合伙）、大连鑫富远泰企业管理合伙企业（有限合伙）
富海新材	深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
东方富海	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）
皖江物流	皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）
宁波富鼎	宁波科发富鼎创业投资合伙企业（有限合伙）
东方富海二号	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）
珠海睿鑫	珠海睿鑫投资合伙企业（有限合伙）
珠海睿祺	珠海睿祺投资合伙企业（有限合伙）
香港睿祺	香港睿祺投资有限公司
珠海睿卓	珠海睿卓投资合伙企业（有限合伙）
河南尚颀	河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）

简称/术语	释义
青岛汇铸	青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业（有限合伙）
华金阿尔法六号	珠海华金阿尔法六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海开物	上海开物投资合伙企业（有限合伙）
开铂银科	开铂银科（成都）创业投资企业
宁波科发	宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）
青岛华芯	青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）
新方正集团	新方正控股发展有限责任公司
方正多层	珠海方正科技多层电路板有限公司
Prioritech 公司	Prioritech Ltd., 系一家以色列上市公司
中国平安	中国平安保险（集团）股份有限公司
主要股东	发行人第一大股东 AMITEC 公司、第二大股东新信产及其一致行动人
东方富海及其关联方	东方富海、东方富海管理、东方富海二号、皖江物流、富海新材、深圳鑫富
君合、本所	北京市君合律师事务所
保荐机构	中信证券股份有限公司
容诚	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《发起人协议》	方正信产、AMITEC 公司、东方富海、东方富海二号、皖江物流、上海开物、开铂银科及宁波科发于 2012 年 5 月 15 日签署的《珠海越亚封装基板技术股份有限公司发起人协议》
《公司章程》	提及当时越亚有限或发行人有效的《珠海越亚封装基板技术有限公司章程》《珠海越亚封装基板技术股份有限公司章程》《珠海越亚半导体股份有限公司章程》及有关章程修正案
《公司章程（草案）》	经发行人 2025 年 5 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过，将于发行人首次公开发行（A 股）股票并在创业板上市后生效施行的《珠海越亚半导体股份有限公司章程（草案）》
本法律意见书	《北京市君合律师事务所关于珠海越亚半导体股份有限公司首次公开发行（A 股）股票并在创业板上市之法律意见书》
《律师工作报告》	《北京市君合律师事务所关于珠海越亚半导体股份有限公司首次公开发行（A 股）股票并在创业板上市之律师工作报告》
《以色列法律意见书》	Shibolet & Co. Advocates & Notaries 于 2025 年 8 月 31 日出具的《法律意见书》
《关于香港越亚的香港法律意见书》	君合律师事务所于 2025 年 8 月 11 日出具的有关越亚封装基板（香港）有限公司的法律意见
《关于美国越亚的尽职调查备忘录》	Jun He Law Offices LLC 根据 Jun He Law Office, P.C. 出具的法律意见于 2025 年 8 月 8 日出具的有关 Access Technologies USA 的特定事项的备忘录
境外法律意见书	提及当时，《以色列法律意见书》《关于香港越亚的香港法律意见书》《关于美国越亚的尽职调查备忘录》的单称或合称

简称/术语	释义
《专利法律意见书》	广州嘉权专利商标事务所有限公司根据美国当地专利代理机构 Buchalter Law Firm、日本当地专利代理机构弁理士法人オリーブ 国際特許事務所、韩国代理机构 KNK IP LAW FIRM、以色列代理机构 Fisher-Friedman IP Group、中国台湾当地代理亚律国际专利商标联合事务所的核查意见，于 2025 年 8 月 13 日出具的关于发行人及其子公司境外专利情况的《关于珠海越亚半导体股份有限公司的境外专利权利情况核查报告》
《审计报告》	容诚于 2025 年 8 月 26 日出具的《珠海越亚半导体股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]510Z0200 号）
《纳税鉴证报告》	容诚于 2025 年 8 月 26 日出具的《珠海越亚半导体股份有限公司主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（容诚专字[2025]510Z0437 号）
《内控报告》	容诚于 2025 年 8 月 26 日出具的《珠海越亚半导体股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2025]510Z0201 号）
《招股说明书》	发行人为本次发行而编制的《珠海越亚半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》及其修订稿
企业公示系统	中华人民共和国国家市场监督管理总局主办之国家企业信用信息公示系统
教育部	中华人民共和国教育部
珠海市监局	珠海市市场监督管理局，原称为广东省珠海市工商行政管理局
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
《公司法》	第八届全国人民代表大会常务委员会于 1993 年 12 月 29 日通过、于 1994 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及其后不时的修改、补充或修订
《证券法》	第九届全国人民代表大会常务委员会于 1998 年 12 月 29 日通过、于 1999 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》及其后不时的修改、补充或修订
《首发注册管理办法》	《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令 2023 年第 205 号，中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布）
《创业板上市规则》	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（深证上[2025]394 号，深圳证券交易所于 2025 年 4 月 25 日颁布）
《证券投资基金法》	第十届全国人民代表大会常务委员会于 2003 年 10 月 28 日通过、于 2004 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及其后不时的修改、补充或修订
《私募基金管理办法》	由中国证监会于 2014 年 8 月 21 日颁布并生效的《私募投资基金监督管理暂行办法》及其后不时的修改、补充或修订
法律法规	提及当时公布并生效的中国法律、法规、规章以及规范性文件
中国	中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省，为且仅为本法律意见书之目的，特指中国内地地区）
A 股	获准在深圳证券交易所或上海证券交易所上市的以人民币标明价值、以人民币认购和进行交易的股票
元	除非上下文另有所指，一般指人民币元

注：本法律意见书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过

程中的四舍五入所形成。

# 正文

## 一、本次发行的批准和授权

### （一）发行人对本次发行的批准

#### 1. 董事会对本次发行的批准

2025年3月10日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》等与本次发行的有关议案，并将需要提交股东大会审议的议案提交发行人拟于2025年3月31日召开的2024年年度股东大会审议。

#### 2. 股东大会对本次发行的批准

2025年3月31日，发行人召开2024年年度股东大会。出席会议的股东及股东代表19名，代表股份891,673,045股，占发行人总股本的100%。该会议以逐项表决方式审议并通过了发行人董事会提交的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》等与本次发行的有关议案。

### （二）发行人本次发行方案的主要内容

发行人本次发行方案的主要内容详见《律师工作报告》正文第一章“本次发行的批准和授权”之（二）“发行人本次发行方案的主要内容”所述。

### （三）发行人股东大会对本次发行的授权

发行人2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》，股东大会授权董事会或董事会授权代表在公司本次发行决议范围内全权办理与本次发行有关的事宜。

综上所述，本所律师认为：

#### 1. 发行人董事会及股东大会依照法定程序作出了批准本次发行的决议；

2. 根据有关法律法规以及《公司章程》等规定，上述关于本次发行的决议内容合法、有效；

3. 发行人股东大会授权董事会办理有关本次发行事宜的授权程序、授权范围合法有效；

4. 发行人本次发行尚需经深交所发行上市审核并取得中国证监会同意注册的决定，发行人股票的上市交易尚需经深交所同意。

## **二、本次发行的主体资格**

### **（一）发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司**

发行人的前身越亚有限为 2006 年 4 月 26 日成立的有限责任公司，越亚有限按照截至 2012 年 4 月 30 日的经审计的账面净资产值于 2012 年 7 月 31 日折股整体变更为股份公司。

发行人现持有珠海市监局于 2021 年 11 月 12 日核发的统一社会信用代码为 91440400787921507Y 的《营业执照》，住所为珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号 FPC 厂房，商事主体类型为股份有限公司（中外合资、未上市），注册资本为 89,167.3045 万元，法定代表人为陈先明。

### **（二）发行人持续经营时间在三年以上**

发行人前身越亚有限成立于 2006 年 4 月 26 日，于 2012 年 7 月 31 日整体变更为股份有限公司，发行人自成立之日起持续经营在三年以上。

### **（三）发行人不存在需要终止的情形**

根据发行人的工商登记材料、现行有效的营业执照、《公司章程》及其出具的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，发行人为永久存续的股份有限公司；截至本法律意见书出具之日，发行人有效存续且不存在股东会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销及经营管理发生严重困难、通过其他途径不能解决而被人民法院依法解散等根据法律法规以及《公司章程》规定需要终止的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人系依法设立且持续经营三年以上的股份有

限公司，截至本法律意见书出具之日，发行人依法有效存续，不存在根据法律、法规和规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，具备本次发行上市的主体资格。

### **三、本次发行的实质条件**

经本所律师核查，发行人已具备《公司法》《证券法》《首发注册管理办法》《创业板上市规则》等法律法规规定的申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的实质条件：

#### **（一）本次发行符合《公司法》规定的相关条件**

根据发行人 2024 年年度股东大会就本次发行作出的有关决议及《招股说明书》，发行人本次发行的股票均为人民币普通股，每股发行条件和价格相同，同种类的每一股份具有同等权利；本次发行的股票每股面值为 1 元，每股发行价格将超过票面金额。

据此，本次发行符合《公司法》第一百四十二条、第一百四十三条和第一百四十八条的规定。

#### **（二）本次发行符合《证券法》规定的相关条件**

1. 根据发行人《公司章程》、内部管理制度文件、发行人董事会、监事会、股东（大）会会议文件及发行人相关资料的记载及发行人出具的书面确认，并经本所律师核查，发行人已按《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定设立了股东会、董事会、审计委员会，选举了董事、独立董事，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并根据发行人的业务运作需要设置了必要的职能部门和机构。据此，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2. 根据《招股说明书》《审计报告》、发行人及其境内子公司所在地主管部门出具的证明文件及发行人出具的书面确认，并经本所律师具备的法律专业知识所能作出的合理判断，发行人在报告期内具有持续的运营记录，不存在影响其持续经营的法律障碍。据此，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3. 根据《审计报告》，容诚已就发行人报告期内的财务会计报告出具了无保留意见的审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4. 根据《以色列法律意见书》、发行人及其主要股东出具的书面确认，并经本所律师通过中国裁判文书网的公示信息查询，发行人及其主要股东报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5. 如本章第（四）部分“发行人本次发行符合《创业板上市规则》规定的相关条件”所述，发行人本次发行符合《证券法》第四十七条的规定。

综上所述，本次发行符合《证券法》规定的相关条件。

### **（三）本次发行符合《首发注册管理办法》规定的相关条件**

#### **1. 主体资格**

如本法律意见书正文第二章“本次发行的主体资格”所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；如本章第（二）部分“本次发行符合《证券法》规定的相关条件”之第1项及本法律意见书正文第十四章“发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

据此，本次发行符合《首发注册管理办法》第十条的规定。

#### **2. 财务与会计**

根据容诚向发行人出具的无保留意见的《审计报告》《内控报告》、发行人出具的书面确认，并经本所律师对发行人财务总监、容诚相关项目经办人员进行访谈，以及本所律师具备的法律专业知识所能够作出的合理判断，截至申报基准日，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关信息披露规定的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，容诚已就发行人报告期内的财务会计报告出具了无保留意见的审计报告；发行人已建立健全的内部控制制度，并能有效执行；发行人的内部控制制度能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，容诚已经向发行人出具了无保留意见的《内控报告》。

据此，本次发行符合《首发注册管理办法》第十一条的规定。

### 3. 业务完整

如本法律意见书正文第五章“发行人的独立性”所述，发行人资产完整，业务、人员、财务和机构独立于主要股东及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；如本法律意见书正文第九章“关联交易及同业竞争”所述，发行人与主要股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。据此，本次发行符合《首发注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

如本法律意见书正文第六章“发起人和股东”、第七章“发行人的股本及其演变”、第八章“发行人的业务”及第十五章“发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化”所述，根据发行人出具的书面确认，并经本所律师查验发行人的工商登记材料和报告期内股东（大）会、董事会、监事会的会议文件，发行人主营业务、控制权、管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；如本法律意见书正文第六章“发起人和股东”及第七章“发行人的股本及其演变”所述，根据发行人及其主要股东出具的书面确认，并经本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人主要股东所持发行人的股份权属清晰，发行人最近二年一直无实际控制人，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。据此，本次发行符合《首发注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

如本法律意见书正文第十章“发行人的主要财产”、第十一章“发行人的重大债权债务”及第二十章“诉讼、仲裁或行政处罚”所述，根据《审计报告》《专利法律意见书》、发行人出具的书面确认并经本所律师查阅发行人主要财产的权属证书、查册文件、重要业务合同等资料，截至申报基准日，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在未披露的重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项；根据本所律师具备的法律专业知识所能够作出的合理判断，截至申报基准日，发行人不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。据此，本次发行符合《首发注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

#### 4. 规范运营

根据《公司章程》《招股说明书》《审计报告》及发行人出具的书面确认，如本法律意见书正文第八章“发行人的业务”所述，发行人的主营业务为从事先进封装关键材料和产品的研发、生产以及销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），发行人的主营业务属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》（2023年5月），发行人所处行业为“CH39-8 计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件及电子专用材料制造”；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，发行人的主营业务属于鼓励类之“二十八、信息产业”；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人所处行业为“高储能和关键电子材料制造”之“电子专用材料制造”；根据《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》，发行人所处行业为“集成电路及专用设备制造”之“电子专用材料制造”。根据发行人及其境内子公司所在地主管部门出具的证明文件、境外法律意见书和发行人出具的书面确认，发行人的生产经营范围符合法律法规的规定，符合国家产业政策。据此，本次发行符合《首发注册管理办法》第十三条第一款的规定。

如本法律意见书正文第二十章“诉讼、仲裁或行政处罚”所述，并根据发行人及其境内子公司所在地主管部门出具的证明文件、《以色列法律意见书》、发行人及其主要股东出具的书面确认，并经本所律师通过中国裁判文书网的公示信息查询，发行人及其主要股东报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。据此，本次发行符合《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

如本法律意见书正文第二十章“诉讼、仲裁或行政处罚”所述，根据发行人董事、监事和高级管理人员的无犯罪记录证明，以及发行人董事、监事和高级管理人员出具的书面确认，并经本所律师通过中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）、深交所网站、上海证券交易所网站、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）的公示信息查询，发行人董事、监事和高级管理人员不存在报告期内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪

正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。据此，本次发行符合《首发注册管理办法》第十三条第三款的规定。

#### **（四）发行人本次发行符合《创业板上市规则》规定的相关条件**

1. 如本章第（三）部分“本次发行符合《首发注册管理办法》规定的相关条件”所述，发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2. 根据发行人 2024 年年度股东大会就本次发行作出的有关决议及《招股说明书》，本次发行后发行人的股本总额将不低于 3,000 万元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3. 根据发行人 2024 年年度股东大会就本次发行作出的有关决议及《招股说明书》，本次发行的股票数量不低于 99,074,783 股（不含行使超额配售选择权发行的股票数量），发行数量不低于本次发行完成后股份总数的 10%，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4. 根据《招股说明书》，发行人本次发行选择的具体上市标准为“最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元”。根据《审计报告》及发行人出具的书面确认，发行人最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项、第 2.1.2 条第（一）项的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《首发注册管理办法》《创业板上市规则》等法律法规规定的申请首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件。

## **四、发行人的设立**

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，本所律师认为：

1. 发行人设立的程序、资格、条件和方式等均符合当时的法律法规的规定，并取得有权部门的批准；

2.发行人的发起人在越亚有限整体变更为股份公司过程中所签署的《发起人协议》《公司章程》等文件的内容符合当时的法律法规的规定，未因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷；

3.越亚有限整体变更为股份公司过程中已经履行了必要的审计、评估及验资程序，符合当时的法律法规的规定；

4.发行人创立大会的召集、召开方式、所议事项及决议内容符合当时的法律法规的规定。

## **五、发行人的独立性**

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，本所律师认为，截至申报基准日，发行人的资产独立、完整，业务、人员、财务和机构独立于主要股东及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## **六、发起人和股东**

### **（一）发行人的发起人股东**

根据《公司章程》《发起人协议》、发行人的工商登记材料、发行人出具的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统的公示信息查询，发行人的发起人共有8名，分别为方正信产、AMITEC公司、东方富海、开铂银科、皖江物流、上海开物、宁波科发及东方富海二号。截至申报基准日，发行人的发起人的具体情况详见《律师工作报告》正文第六章“发起人和股东”之（一）“发行人的发起人股东”所述。

上述全体发起人股东在发起设立发行人时均依法有效存续，具备根据当时法律、法规和规范性文件规定的担任股份公司发起人并进行出资的资格；发起人的人数、住所、出资比例符合当时有效的有关法律、法规和规范性文件的规定。

### **（二）发起人股东的出资**

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，本所律师认为：

1.越亚有限整体变更为股份有限公司时，发起人股东已投入发行人的资产的产权关系清晰，发起人将上述资产投入发行人不存在法律障碍；

2.发行人系由有限责任公司整体改制设立，发行人不存在将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股发行人的情形，亦不存在以其在其他企业中的权益折价入股的情形；

3.越亚有限在整体变更为股份有限公司时，发起人投入发行人的资产由发起人持有，不存在法律障碍或风险。

### **（三）发行人的现有股东**

根据发行人的《公司章程》、股东名册、发行人出具的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人现有股东共 19 名，发行人股东及持股情况详见《律师工作报告》正文第六章“发起人和股东”之（三）“发行人的现有股东”所述。

根据发行人及其股东提供的资料、发行人及其股东出具的书面确认，并经本所律师核查，本所律师认为：

1.发行人的股东均依法有效存续，具有法律法规规定担任股份公司股东并向公司出资的资格；

2.华金领瑞、富海新材、东方富海、宁波富鼎、皖江物流、华金阿尔法六号、东方富海二号、河南尚颀、青岛汇铸已经按照《证券投资基金法》《私募基金管理办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规的相关规定，履行了私募基金备案手续。

### **（四）发行人的控股股东和实际控制人**

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，本所律师认为，发行人最近两年一直无控股股东、无实际控制人，且不存在控制权发生变更的情形；发行人无控股股东、无实际控制人并不影响其治理结构的有效性。

### **（五）特殊表决权安排**

根据发行人《公司章程》、工商登记材料、发行人及其全体股东出具的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人股份上不存在特殊表决权安排。

### **（六）发行人穿透至最终持有人情况**

根据发行人的工商登记材料、股东名册、发行人股东出具的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统的公示信息查询，发行人经穿透后的股东人数未超过

200人，符合《证券法》等法律法规的相关规定。

## 七、发行人的股本及其演变

### （一）发行人设立时的股权设置及股本结构

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。

### （二）越亚有限的股权变动情况

#### 1. 越亚有限的设立及历次股权变动情况

根据发行人提供的资料、发行人出具的书面确认并经本所律师核查，越亚有限的设立及历次股权变动情况详见《律师工作报告》正文第七章“发行人的股本及其演变”之（二）“越亚有限的股权变动情况”所述。

#### 2. 有限公司阶段的出资瑕疵

就越亚有限上述股权变动事宜，本所律师注意到存在以下瑕疵：

（1）根据国家工商行政管理总局、商务部、海关总署、国家外汇管理局于2006年4月24日联合颁布的《关于印发〈关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见〉的通知》（以下简称《通知》）第十五条规定，“外商投资的公司增加注册资本，有限责任公司（含一人有限公司）和以发起方式设立的股份有限公司的股东应当在公司申请注册资本变更登记时缴付不低于百分之二十的新增注册资本，其余部分的出资时间应符合《公司法》、有关外商投资的法律和《公司登记管理条例》的规定。其他法律、行政法规另有规定的，从其规定。”

经核查，越亚有限2007年2月第一次增资时，其股东方正多层、AMITEC公司的第一期出资期限（新增注册资本从企业营业执照变更之日起3个月到位15%）不符合《通知》的上述规定；此外，越亚有限上述股东也未在审批机关批准的出资期限内（2008年底前）履行完毕出资义务。

根据发行人出具的书面确认，截至本法律意见书出具之日：（a）方正多层、AMITEC公司已缴足出资，且在方正多层、AMITEC公司延期出资期间，公司各项经营运行情况正常，不存在任何公司债权人因股东延期出资向公司主张权利或要求延期出资股东缴纳出资的情形；（b）越亚有限上述变更及后续股权转让、增

资和改制设立股份公司均已经获得珠海市和广东省有权商务部门的批准；(c) 越亚有限自设立以来,通过了历年的外商投资企业联合年检或进行了信息报送；(d) 发行人及其前身越亚有限均未因上述瑕疵而收到批准机关和登记机关的处罚通知或类似的文件。此外,根据中华人民共和国商务部于2014年6月18日颁布的《商务部关于改进外资审核管理工作的通知》(商资函[2014]314号),“取消对外商投资(含台、港、澳投资)的公司(以下简称公司)首次出资比例、货币出资比例和出资期限的限制或规定”,外商投资企业的出资比例已经不再受到《通知》的相关限制。

因此,本所律师认为,上述出资瑕疵对越亚有限的合法存续和本次发行上市不构成实质障碍。

(2) 在有限责任公司阶段,发行人国有股东的股权变动存在未履行评估及评估核准/备案、进场交易等程序的情形。2012年7月16日,北京大学出具《北京大学关于确认珠海越亚封装基板有限公司过往经济行为的批复》(校发[2012]77号),确认越亚有限上述设立、增资、转让股权等过往经济行为的决策和批准程序合法有效,该等经济行为中不存在国有资产流失等损害国有资产及损害国有上市公司利益的情形。

根据《国务院办公厅关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》(国办函[2001]58号),北京大学依据有关法规,对经营性国有资产具有占有、使用、一定的处置和收益分配的权利;北京大学对所管理的国有资产承担资产保值责任,并对经营性国有资产行使出资人权力。

### **(三) 发行人的股份变动情况**

#### **1. 发行人的设立及历次股份变动情况**

根据发行人提供的资料、发行人出具的书面确认并经本所律师核查,发行人的设立及历次股份变动情况详见《律师工作报告》正文第七章“发行人的股本及其演变”之(三)“发行人的股份变动情况”所述。

#### **2. 股份公司阶段的出资瑕疵**

就发行人上述股份变动事宜,本所律师注意到2018年7月第二次增资存在以下瑕疵:

(1) 方正信产在完成国资审批及评估备案程序之前即已对发行人进行增资，该次增资程序存在瑕疵。但鉴于北京大学已于 2018 年 10 月 24 日出具《关于同意北大方正信息产业集团有限公司购买珠海越亚半导体股份有限公司增发股份的批复》，教育部亦于 2019 年 1 月 25 日签发《国有资产评估项目备案表》，对此次增资涉及的资产评估结果予以备案，本所律师认为，该等瑕疵不构成本次发行上市的实质障碍。

(2) 方正信产、AMITEC 公司和青岛华芯，及青岛华芯所持公司股份的受让方珠海睿鑫、珠海睿祺、香港睿祺、珠海睿卓，均存在未按照公司股东大会决议和《公司章程》规定的时间出资的情形。

根据公司 2018 年第六次临时股东大会决议与《公司章程》，方正信产、AMITEC 公司、青岛华芯认缴此次增资出资款的实缴安排如下：

序号	新股认购方	第一期缴纳时间	第一期缴纳金额(元)	第二期缴纳时间	第二期缴纳金额(元)
1.	方正信产	2018.07.15 前	48,515,180	2018.09.30 前	48,515,180
2.	AMITEC 公司		48,515,180		48,515,180
3.	青岛华芯		2,969,640		2,969,640

方正信产、AMITEC 公司和青岛华芯均存在未按照上表所示的出资款缴纳时间出资的情形。

此外，青岛华芯于 2019 年 6 月将其所持有的发行人股份及对应的出资义务分别转让给珠海睿鑫、珠海睿祺、香港睿祺、珠海睿卓后，珠海睿鑫、珠海睿祺、香港睿祺、珠海睿卓亦未按修订后的《公司章程》和公司股东大会决议规定的时间（2019 年 6 月 20 日前）缴纳认购增资款，该等股东的前述出资亦存在瑕疵。

但鉴于根据发行人提供的《验资报告》（华税银河验字 2019-01-0050 号、天职业字[2019]34894 号）、2019 年第五次临时股东大会会议文件及发行人出具的书面确认：(a) 截至 2019 年 4 月 29 日，发行人已收到股东方正信产及 AMITEC 公司以货币缴纳的新增注册资本 87,022,744 元；截至 2019 年 9 月 24 日，发行人已收到股东珠海睿鑫、珠海睿祺、香港睿祺及珠海睿卓以货币缴纳的新增注册资本合计 2,663,354 元；(b) 发行人 2019 年第五次临时股东大会对方正信产、AMITEC 公司、青岛华芯、珠海睿鑫、珠海睿祺、香港睿祺、珠海睿卓上述延期

出资行为予以确认；其他股东对上述延期出资行为没有任何异议，不会提出任何诉讼或仲裁，亦不会因此追究该等股东的任何责任；(c)上述股东延期出资期间，公司各项经营运行情况正常，不存在任何公司债权人因股东延期出资向公司主张权利或要求延期出资股东缴纳出资的情形。因此，本所律师认为，上述延期出资事项不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

#### **(四) 发行人的股份权利限制**

根据发行人及其全体股东出具的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人的股份不存在被质押或冻结的情形。

### **八、发行人的业务**

#### **(一) 发行人的经营范围和经营方式**

根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》，并经本所律师通过企业公示系统的公示信息查询，发行人经核准的经营范围为，“一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

根据《招股说明书》及发行人出具的书面确认，发行人主要从事先进封装关键材料和产品的研发、生产以及销售，主要产品包括IC封装载板和嵌埋封装模组。

根据发行人及其境内子公司所在地相关主管机关出具的证明文件及发行人出具的书面确认，经本所律师核查，截至申报基准日，发行人及其境内子公司的经营范围和主营业务符合有关法律法规的规定，并已取得从事经营业务所必需的资质、政府许可或批准，且该等资质、政府许可或批准合法有效，不存在该等资质、政府许可和批准被撤销、吊销的情形。

#### **(二) 发行人在中国大陆以外经营活动**

##### **1. 基本情况**

根据境外法律意见书和发行人出具的书面确认，截至本法律意见书出具之日，

发行人存在两家境外子公司，即香港越亚和美国越亚，其基本情况及涉及的境外投资相关程序详见《律师工作报告》正文第八章“发行人的业务”之（二）“发行人在中国大陆以外经营活动”所述。

## 2. 涉及的境外投资相关程序瑕疵

本所律师注意到，发行人相关境外投资程序存在瑕疵，具体情况如下：

### （1）发行人投资设立香港越亚未办理发改部门的境外投资核准手续

根据当时适用的《境外投资项目核准暂行管理办法》（国家发展和改革委员会令第21号）的规定，“中方投资用汇额1000万美元以下的其他项目，由各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团等省级发展改革部门核准，项目核准权不得下放”，但《境外投资项目核准暂行管理办法》未明确规定未办理发改部门核准手续的具体罚则。

根据广东省发展和改革委员会（以下简称“**广东省发改委**”）相关工作人员的电话回复，在广东省发改委的实践操作中，《企业境外投资管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第11号）于2018年3月1日生效前，对于在境外设立但不涉及固定资产投资的贸易类公司，不强制要求办理发改委核准或备案手续，后续亦不需要补办相关手续，且广东省发改委没有对类似情形要求整改或予以处罚的先例。

根据发行人出具的书面确认，香港越亚为贸易公司，不涉及固定资产投资；发行人在办理相关商务、外汇审批手续时未被要求提供发改主管部门的审批或备案文件，亦未被发改主管部门要求补办相关手续；若将来广东省发改委要求发行人就上述境外投资事项补办手续时，发行人将严格按照发改委的要求执行。

根据“信用广东”于2025年8月15日出具的发行人《无违法违规证明公共信用信息报告》及发行人出具的书面确认，并经本所律师通过相关发改主管部门网站的公示信息查询，截至本法律意见书出具之日，发行人未因上述未办理发改核准手续事宜而受到过发改部门的行政处罚。

因此，就发行人投资设立香港越亚未办理发改核准手续事宜，不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

(2) 发行人就香港越亚投资设立美国越亚事宜未办理外汇部门的境外再投资备案手续

根据当时生效的《国家外汇管理局关于发布〈境内机构境外直接投资外汇管理规定〉的通知》(汇发[2009]30号,自2009年8月1日实施)规定,“境内机构已登记境外企业发生长期股权或债权投资、对外担保等不涉及资本变动的重大事项的,境内机构应在60天内,持境外直接投资外汇登记证、境外直接投资主管部门的核准或者备案文件及相关真实性证明材料到所在地外汇局就上述重大事项办理境外直接投资外汇备案手续”。

根据《中华人民共和国行政处罚法》《外汇管理行政处罚裁量办法》(汇综发[2021]68号)的规定,对在二年内未被发现的违反外汇管理行为,不再给予行政处罚;涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的,上述期限延长至五年,法律另有规定的除外;该期限从违法行为发生之日起计算;违法行为有连续或者继续状态的,从行为终了之日起计算。根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发[2015]13号)的规定,自2015年6月1日起取消境外再投资外汇备案。因此,由于法律法规变化导致境外企业进行再投资时无需办理外汇备案手续,故上述违法状态已经于2015年6月1日终了,且已经超过最高追诉期五年,故该行为受到外汇主管部门行政处罚的概率较小。

根据发行人出具的书面确认,并经本所律师通过国家外汇管理局网站(<http://www.safe.gov.cn/safe/whxzcfxccx/>)的公示信息查询,截至本法律意见书出具之日,发行人未因此受到外汇主管部门的行政处罚。

因此,发行人就香港越亚投资设立美国越亚未办理外汇备案手续事宜,不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

### **(三) 发行人经营范围的变更**

根据发行人提供的《公司章程》、工商登记材料、相关董事会和股东(大)会会议文件,并经本所律师通过企业公示系统的公示信息查询以及发行人出具的书面确认,报告期内,发行人经营范围发生过1次变化,且发行人已经于2023年4月12日就变更后的经营范围于珠海市监局办理了工商备案手续。

#### **（四）发行人的主营业务**

根据《审计报告》《招股说明书》、发行人出具的书面确认，并经本所律师核查，报告期内，发行人一直从事先进封装关键材料和产品的研发、生产以及销售，主营业务未发生过变更。发行人报告期内的业务收入主要来自其主营业务，发行人的主营业务突出。

#### **（五）发行人的持续经营**

根据《公司章程》、发行人出具的书面确认并经本所律师核查，发行人为永久存续的股份有限公司。根据发行人出具的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统、中国执行信息公开网和中国裁判文书网的公示信息查询，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在根据法律法规及《公司章程》规定需要其解散或终止的情形，不存在其主要生产经营性资产被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在现行法律法规禁止或限制其开展目前业务的情形，发行人依照法律的规定在其经营范围内开展经营活动，不存在持续经营的法律障碍。

据此，本所律师认为，发行人不存在影响其持续经营的法律障碍。

### **九、关联交易及同业竞争**

#### **（一）发行人的关联方**

根据《公司法》《创业板上市规则》等法律法规的有关规定、《以色列法律意见书》、中国平安年度报告及半年度报告，发行人及其董事、监事、高级管理人员、股东出具的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统的公开信息查询，截至申报基准日，发行人主要关联方及其关联关系详见《律师工作报告》正文第九章“关联交易及同业竞争”之（一）“发行人的关联方”所述。

#### **（二）关联交易**

根据《审计报告》及发行人出具的书面确认，报告期内发行人与关联方之间存在的关联交易详见《律师工作报告》正文第九章“关联交易及同业竞争”之（二）“关联交易”所述。

#### **（三）董事会和股东会和对报告期内关联交易的审议**

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人报告期

内的关联交易已经发行人独立董事专门会议、董事会及股东会审议，关联交易的定价是基于正常的市场交易条件和市场化原则及进行商业化磋商的基础上进行的，定价公允，对发行人的生产经营不构成重大不利影响。

#### **（四）发行人制定的关联交易决策程序**

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人《公司章程》《公司章程（草案）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》中对关联交易的决策原则、权限、程序等作出了明确规定，该等规定符合相关法律法规。

#### **（五）同业竞争**

根据发行人的工商登记材料、《以色列法律意见书》、发行人及主要股东出具的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统的公示信息查询，截至申报基准日，发行人的第一大股东 AMITEC 公司及其控股股东和实际控制人、第二大股东新信产及其一致行动人巨人网盛和新方正集团直接或间接控制的企业均不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

#### **（六）避免同业竞争及规范和减少关联交易的措施**

就避免同业竞争事项和减少和规范关联交易事项，发行人第一大股东 AMITEC 公司及其控股股东 Priortech 公司、AMITEC 公司实际控制人 Rafi Amit 和 Yotam Stern、发行人第二大股东新信产及其一致行动人、新方正集团、东方富海及其关联方、发行人董事、高级管理人员均已出具相关承诺。

#### **（七）发行人对关联交易和同业竞争事项的披露**

根据《招股说明书》和发行人出具的书面确认，《招股说明书》中充分披露了发行人报告期内有关关联交易和避免同业竞争的承诺和措施，无重大遗漏或重大隐瞒。

## **十、发行人的主要财产**

### **（一）房产**

根据发行人提供的不动产权证书、不动产档案查询文件、发行人出具的书面确认，截至申报基准日，发行人及其境内子公司拥有境内房产20项，其具体情况

详见《律师工作报告》正文第十章“发行人的主要财产”之（一）“房产”所述。

根据发行人出具的书面确认，并经本所律师查验该等房产的权属证书、不动产档案查询文件，以及本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其境内子公司合法拥有上述房产所有权，并已取得相应的权属证书，该等房产不存在产权方面的纠纷；珠海越芯和南通越亚持有的房产虽设置了抵押，但不影响发行人及其境内子公司的正常使用；发行人持有的房产不存在抵押、查封等他项权利措施。

## （二）土地使用权

根据发行人提供的不动产权证书、不动产档案查询文件、发行人出具的书面确认，截至申报基准日，发行人及其境内子公司拥有的土地使用权4项，其具体情况详见《律师工作报告》正文第十章“发行人的主要财产”之（二）“土地使用权”所述。

根据发行人出具的书面确认，并经本所律师查验该等土地使用权的权属证书、不动产档案查询文件，以及本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其境内子公司合法拥有上述土地使用权，并已取得相应的权属证书，该等土地使用权不存在产权方面的纠纷；珠海越芯和南通越亚持有的土地使用权虽设置了抵押，但不影响发行人及其境内子公司的正常使用；发行人持有的土地使用权不存在抵押、查封等他项权利措施。

## （三）知识产权

### 1. 专利

根据发行人提供的境内专利的权属证书及其出具的书面确认、中华人民共和国知识产权局出具的《证明》，并经本所律师通过中国及多国专利审查信息查询网（<https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn>）的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其子公司持有境内专利106项，境内专利具体情况详见《律师工作报告》附件一“专利”之（一）“境内专利”所述，该等境内专利不存在质押等他项权利限制。

根据《专利法律意见书》，截至申报基准日，发行人及其子公司持有境外专利278项，境外专利具体情况详见《律师工作报告》附件一“专利”之（二）“境

外专利”所述，该等境外专利不存在质押等他项权利限制。

根据《专利法律意见书》和发行人出具的书面确认，并经本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其子公司拥有的上述专利不存在产权方面的纠纷。

## 2. 注册商标

根据发行人提供的《商标注册证》及其出具书面确认、商标局出具的关于发行人拥有的商标注册证明，并经本所律师通过中国商标网（<https://cas.sbj.cnipa.gov.cn/cas/>）的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其子公司持有境内注册商标11项，具体情况详见《律师工作报告》附件二“注册商标”所述，该等注册商标不存在质押等他项权利限制。

根据发行人出具的书面确认，并经本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其子公司拥有的上述注册商标不存在产权方面的纠纷。

## 3. 计算机软件著作权

根据发行人提供的《计算机软件著作权证书》及其出具的书面确认、中国版权保护中心查册文件，并经本所律师通过中国版权保护中心网站（<http://www.ccopyright.com.cn/>）的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其子公司持有计算机软件著作权5项，具体情况详见《律师工作报告》附件三“计算机软件著作权”所述，该等计算机软件著作权不存在质押等他项权利限制。

根据发行人出具的书面确认，并经本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其子公司拥有的上述计算机软件著作权不存在产权方面的纠纷。

## （四）发行人的对外投资情况

根据发行人提供的资料及其出具的书面确认，截至申报基准日，发行人拥有3家境内全资子公司、2家境外全资子公司，以及1家境内参股公司。发行人子公司及参股公司的具体情况详见《律师工作报告》正文第十章“发行人的主要财产”之（四）“发行人的对外投资情况”所述。

根据《关于香港越亚的香港法律意见书》《关于美国越亚的法律尽职调查报告》及发行人出具的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统的公示信息查询，截至申报基准日，发行人全资子公司依法设立并有效存续，发行人持有的上述子公司的股权（份）不存在产权方面的纠纷，亦不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情况；南通越亚持有的参股公司的股权不存在产权方面的纠纷，亦不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情况。

### （五）租赁物业

根据发行人提供的资料及其出具的书面确认，并经本所律师核查，截至申报基准日，发行人及其境内子公司租赁共计 1 处物业具体情况详见《律师工作报告》正文第十章“发行人的主要财产”之（五）“租赁物业”所述。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上述租赁物业的相关租赁合同未办理租赁备案登记手续。根据《商品房屋租赁管理办法》第 14 条、第 23 条的相关规定，租赁合同当事人未能在合同订立后 30 日内办理房屋租赁备案手续的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。因此，发行人作为合同一方当事人，未能按时办理房屋租赁备案手续，存在被给予行政处罚的风险，但鉴于：（1）《商品房屋租赁管理办法》第 23 条中将“责令改正”作为给予行政处罚的前置条件，只有在责令改正期间内，依旧未办理租赁房屋备案的，主管机关方可对其给予行政处罚。根据公司出具的书面确认，如主管机关要求公司办理租赁备案登记的，公司将根据主管机关的要求相应办理备案手续；（2）根据“信用广东”于 2025 年 8 月 15 日出具的发行人《无违法违规证明公共信用信息报告》和发行人出具的书面确认，并经本所律师通过当地住房和城乡建设局网站（<https://zjj.zhuhai.gov.cn/>）的公示信息查询，发行人在报告期内不存在因违反上述相关规定而受到主管部门处罚的情形；（3）根据《中华人民共和国民法典》第 706 条的规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力，上述租赁合同已经构成对双方当事人具有约束力的法律文件。根据公司出具的书面确认，截至本法律意见书出具之日，该等租赁物业合同履行正常，未发生租赁违约的情形。

综上所述，本所律师认为，上述租赁房屋未办理房屋租赁备案手续对发行人的生产经营不构成重大不利影响，不会构成本次发行上市的实质性法律障碍。

## **十一、发行人的重大债权债务**

### **（一）重大合同**

根据发行人提供的资料，截至申报基准日，发行人及其子公司正在履行的对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的重大合同详见《律师工作报告》正文第十一章“发行人的重大债权债务”之（一）“重大合同”所述。

### **（二）重大侵权之债**

根据《审计报告》、发行人出具的书面确认、发行人及其境内子公司所在地主管部门出具的证明文件，并经本所律师核查，发行人于报告期内不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

### **（三）发行人与关联方的重大债权债务关系及担保情况**

根据《审计报告》、发行人提供的资料及其出具的书面确认，截至申报基准日，除《律师工作报告》正文第九章“关联交易及同业竞争”中披露的发行人与关联方之间的关联交易外，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系，发行人不存在为关联方提供担保的情形。

### **（四）其他应收款、其他应付款的情况**

根据《审计报告》及发行人出具的书面确认，截至申报基准日，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的生产经营活动发生，合法有效。

## **十二、发行人的重大资产变化及收购兼并**

### **（一）发行人设立至今的合并、分立、增资扩股、减少注册资本、重大收购或出售资产等行为**

根据发行人出具的书面确认并经本所律师核查，发行人自设立以来未发生过合并、分立、减少注册资本和重大收购或出售资产的行为。

发行人设立至今的历次增资扩股情况详见《律师工作报告》正文第四章“发行人的设立”及第七章“发行人的股本及其演变”所述。

## **(二) 发行人拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为**

根据发行人出具的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人无资产置换、资产剥离、资产出售或其他资产收购计划。

## **十三、发行人公司章程的制定与修改**

根据发行人提供的资料、发行人出具的书面确认并经本所律师核查，本所律师认为：

1. 发行人对《公司章程》的制定及报告期内对《公司章程》的修改已经履行了必要的法定程序，符合法律法规的规定；

2. 发行人现行有效的《公司章程》是根据《公司法》等法律法规规定起草和制定的，《公司章程》的内容符合现行法律法规的规定；

3. 发行人制定的《公司章程（草案）》依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规的规定，《公司章程（草案）》的内容符合现行法律法规的规定，自发行人本次发行上市之日起，即构成规范公司 and 公司股东、董事、高级管理人员权利义务的、具有法律约束力的合法文件。

## **十四、发行人的股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作**

### **(一) 发行人具有健全的组织机构**

根据发行人《公司章程》及发行人出具的书面确认，并经本所律师核查，发行人在报告期内设立了股东（大）会、董事会及董事会下属的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会、监事会、总经理等高级管理人员等健全的组织机构，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范的运行制度。

根据发行人股东大会会议文件，发行人于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，发行人不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

因此，本所律师认为，发行人具有健全、完整的组织机构。

## **（二）发行人股东会、董事会、监事会的议事规则**

根据发行人提供的资料及其出具的书面确认，并经本所律师核查，报告期内，发行人具有健全的股东（大）会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则；截至申报基准日，发行人已取消监事会，并由审计委员会承接并行使监事会职权后，发行人已经修订了相应的《董事会审计委员会工作细则》，监事会议事规则随之失效。

因此，本所律师认为，发行人在报告期内具有健全的股东（大）会、董事会、监事会议事规则，截至申报基准日，由于治理结构的调整，发行人的监事会议事规则已经失效，发行人已经制定了相应的审计委员会工作细则；发行人上述股东（大）会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则（已失效）、审计委员会工作细则符合法律法规的相关规定。

## **（三）发行人股东（大）会、董事会、监事会的召开及决议**

经审阅发行人报告期内历次股东（大）会、董事会、监事会的会议文件，本所律师认为，发行人报告期内历次股东（大）会、董事会、监事会的召开、决议内容及表决程序均合法、合规、真实、有效。

## **（四）股东（大）会或董事会历次授权或重大决策等行为的合法性**

根据发行人提供的资料及其出具的书面确认，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人报告期内股东（大）会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

# **十五、发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化**

## **（一）发行人董事、高级管理人员的情况**

根据《公司章程》、发行人相应股东（大）会、董事会会议文件，并经本所律师通过企业公示系统的公示信息查询，截至本法律意见书出具之日，发行人董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事；发行人高级管理人员共5名，包括总经理1名、副总经理3名、财务总监1名、董事会秘书1名（财务总监兼任）。

根据发行人提供的资料、发行人及其董事和高级管理人员出具的书面确认、

发行人董事和高级管理人员的无犯罪记录证明，本所律师认为，发行人董事人数符合《公司法》第一百二十条的规定；发行人现任董事及高级管理人员均具有法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》所列示的不得担任董事或高级管理人员的情形。

## **（二）发行人董事、监事、高级管理人员报告期内变化情况**

根据发行人报告期内的股东（大）会、董事会和监事会以及职工代表大会会议文件，以及发行人出具的书面确认，并经本所律师核查，发行人报告期内董事、监事、高级管理人员的变化情况详见《律师工作报告》正文第十五章“发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化”之（二）“发行人董事、监事、高级管理人员报告期内变化情况”所述。

根据发行人提供的资料及出具的书面确认，并经本所律师核查，发行人报告期内董事、监事、高级管理人员变化的主要原因系由于董事、监事因个人原因离职，或公司为了完善法人治理结构并符合上市监管要求而作出的主动调整，不构成发行人董事、监事、高级管理人员的重大变化，且相关变动已履行了必要的法律程序；前述人员的变动目的在于促进公司业务发展、提升管理水平、改善公司治理，前述人员变化不会对发行人生产经营产生重大不利影响。

## **（三）独立董事的任职情况**

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人董事会中设有独立董事 3 名，分别为刘庆国、栾依峥、沈璟，发行人独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定；发行人所设立的独立董事的任职资格及其职权范围符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

# **十六、发行人的税务**

## **（一）发行人及其子公司的主要税种、税率**

根据《审计报告》《纳税鉴证报告》及发行人出具的书面确认，并经本所律师核查，本所律师认为，截至申报基准日，发行人及其境内子公司执行的主要税种、税率符合现行法律法规的规定。

## **（二）发行人及其子公司报告期内享受的税收优惠**

根据《审计报告》并经本所律师核查，本所律师认为，发行人及其境内子公司在报告期内享受的于《律师工作报告》中已披露的税收优惠合法、合规、真实、有效。

## **（三）发行人及其子公司报告期内享受的财政补贴**

根据《审计报告》《招股说明书》、发行人提供的其报告期内取得财政补贴的政策依据、收款凭证及其出具的书面确认，发行人及其境内子公司报告期内取得的金额达到 100 万元以上的财政补贴情况详见《律师工作报告》正文第十六章“发行人的税务”之（三）“发行人及其子公司报告期内享受的财政补贴”所述。经本所律师核查，发行人及其境内子公司享受的该等财政补贴均取得了地方政府及相关部门的批准，该等补贴事项合法、合规、真实、有效。

## **（四）发行人报告期内的税务合规情况**

根据发行人出具的书面确认、《关于香港越亚的香港法律意见书》《关于美国越亚的尽职调查备忘录》、发行人及其境内子公司所在地税务主管部门出具的证明文件，并经本所律师通过中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，发行人及子公司报告期内不存在因严重违反税收方面的法律法规而受到主管税务部门行政处罚的情形。

# **十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准**

## **（一）发行人的环境保护**

根据“信用广东”出具的《无违法违规证明公共信用信息报告》以及南通市崇川生态环境局出具的《南通越亚半导体有限公司环保守法情况说明》、发行人出具的书面确认，并经本所律师通过发行人及境内子公司主要经营地环境保护局官方网站（珠海市生态环境局：<http://ssthjj.zhuhai.gov.cn/>；南通市生态环境局：<http://hbj.nantong.gov.cn/>）、中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，发行人及其境内子公司报告期内不存在因违反环保方面法律、法规和规范性文件而受到环保部门处罚情形。

## （二）发行人的产品质量和技术监督标准

根据“信用广东”出具的《无违法违规证明公共信用信息报告》、南通市崇川区市场监督管理局执法稽查科出具的南通越亚《市场主体守法经营状况意见》、发行人出具的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统及中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，发行人及境内子公司报告期内不存在因违反有关质量和技术监督方面的法律法规的规定而受到行政处罚的情形。

## 十八、发行人募集资金的运用

### （一）募集资金的投资项目

根据发行人于2025年5月15日召开的2025年第三次临时股东大会审议并通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》，发行人本次实际募集资金扣除发行费用后的净额，将投入以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投资金额（万元）
面向 AI 领域的高效能嵌埋封装模组扩产项目	109,213.72	103,669.40
研发中心项目	10,746.74	10,746.74
补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计	<b>127,960.46</b>	<b>122,416.14</b>

### （二）发行人本次募集资金投资项目已取得的相关批准/备案

根据发行人提供的资料及其出具的书面确认，本所律师认为，发行人的募集资金投资项目已经根据项目建设进度取得了现阶段必要的批准或备案手续。

### （三）募集资金投资项目与主营业务关系和与他人合作的情况

根据发行人出具的书面确认并经本所律师核查，本次募集资金投资项目将围绕主营业务展开，除补充流动资金项目外，募投项目实施主体为发行人的全资子公司南通越亚，不存在与其他方合作的情形。

## 十九、发行人业务发展目标

根据发行人提供的资料及出具的书面确认，发行人业务发展目标与主营业务

一致；发行人的业务发展目标不属于国家限制类或淘汰类产业项目；发行人业务发展目标符合国家产业方面法律法规的规定，不存在潜在的法律风险。

## **二十、诉讼、仲裁或行政处罚**

### **（一）发行人及其子公司的情况**

1. 根据《审计报告》、发行人及其境内子公司所在地主管部门出具的证明文件、发行人提供的行政处罚决定书及罚款缴纳凭证、《关于香港越亚的香港法律意见书》《关于美国越亚的尽职调查备忘录》、发行人出具的书面确认，经本所律师通过中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，并经本所律师核查，报告期内发行人及其境内子公司受到 2 项行政处罚，具体情况详见《律师工作报告》正文第二十章“诉讼、仲裁或行政处罚”之（一）“发行人及其子公司的情况”所述。经本所律师核查，发行人及珠海越芯的违法情形均不构成重大违法行为。

2. 根据《审计报告》《关于香港越亚的香港法律意见书》《关于美国越亚的尽职调查备忘录》、发行人及其境内子公司所在地主管部门出具的证明文件、发行人出具的书面确认，并经本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司在报告期内不存在尚未了结的对发行人造成实质重大不利影响的重大行政处罚；报告期内，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁情况。

### **（二）持有发行人 5%以上股份股东的情况**

根据《以色列法律意见书》、持有发行人 5%以上股份股东出具的书面确认，并经本所律师通过中国裁判文书网、中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，截至申报基准日，持有发行人 5%以上股份的股东在中国境内不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况。

### **（三）发行人董事长、总经理的情况**

根据发行人董事长、总经理的无犯罪记录证明、出具的书面确认，并经本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网、中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人董事长、总经理在中国境内不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况。

#### **(四)本所律师对已经存在的诉讼、仲裁的调查和了解受到下列因素的限制:**

1.本所律师的判断是基于确信上述各方所出具的书面确认以及有关证言证据是按照诚实和信用的原则作出的。

2.根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，基于目前中国法院、仲裁机构的案件受理程序和公告体制限制，本所律师对于发行人及其控股子公司、持股5%以上的股东、发行人的董事长、总经理已经存在的重大法律诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽。鉴于此，本所律师对于发行人及其境内控股子公司、持有发行人5%以上股份的股东、发行人董事长、总经理已经存在的诉讼、仲裁及行政处罚案件的核查尚无法穷尽。

### **二十一、发行人招股说明书法律风险的评价**

本所律师未参与编制《招股说明书》，但就《招股说明书》所涉及的相关法律问题与发行人及保荐机构进行了讨论。本所律师已审阅《招股说明书》及其摘要中引用本法律意见书和《法律意见书》相关内容。本所律师认为，《招股说明书》及其摘要不会因所引用的本法律意见书和《律师工作报告》内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **二十二、本所律师认为需要说明的其他问题**

#### **(一)本次发行上市前制定，并准备在本次发行上市后实施的期权激励计划**

根据发行人提供的资料及出具的书面确认，并经本所律师核查，发行人存在本次发行上市前制定，并准备在本次发行上市后实施的期权激励计划，具体情况详见《律师工作报告》正文第二十二章“本所律师认为需要说明的其他问题”之（一）“本次发行上市前制定，并准备在本次发行上市后实施的期权激励计划”所述。

根据发行人出具的书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，前述激励计划项下的股票期权均未行权。

#### **(二) 社会保险、住房公积金**

根据发行人提供的资料及出具的书面确认，并经本所律师核查，发行人的社会保险、住房公积金缴纳情况详见《律师工作报告》正文第二十二章“本

所律师认为需要说明的其他问题”之（二）“社会保险、住房公积金”所述。

### **（三）股东特殊权利**

根据发行人提供的资料及出具的书面确认，并经本所律师核查，发行人股东特殊权利情况详见《律师工作报告》正文第二十二章“本所律师认为需要说明的其他问题”之（三）“股东特殊权利”所述。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日：（1）发行人历史上与股东签署的估值调整条款未被触发，任何一方无权要求对公司的投资进行估值调整；（2）发行人历史上与股东签署的回购条款已不可撤销、不可恢复且无条件地自始无效；各方就前述对赌安排不存在任何争议或纠纷；（3）发行人历史上与股东签署的其他特殊股东权利条款将于公司向深交所提交IPO申请时全部终止（附有恢复条款）；除本所律师于《律师工作报告》中已披露的特殊股东权利条款外，发行人与股东之间、股东与股东之间不存在其他相关股东特殊权利的协议或类似安排。

## **二十三、本次发行的总体结论性意见**

综上所述，发行人具备申请本次发行的主体资格，本次发行符合《证券法》《公司法》《首发注册管理办法》《创业板上市规则》等有关法律法规规定的实质条件；《招股说明书》及其摘要引用本法律意见书及《律师工作报告》的内容适当；本次发行尚待深交所发行上市审核并取得中国证监会同意注册的决定，发行人股票的上市交易尚需经深交所同意。

本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

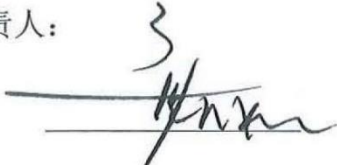
(本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于珠海越亚半导体股份有限公司首次公开发行（A股）股票并在创业板上市之法律意见书》的签署页)

北京市君合律师事务所

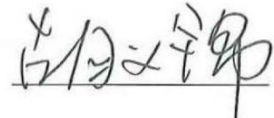
(公章)



负责人：

  
华晓军 律师

经办律师：

  
胡义锦 律师

  
张慧丽 律师

2025 年 9 月 30 日

北京市君合律师事务所

关于

珠海越亚半导体股份有限公司

首次公开发行（A 股）股票并在创业板上市

之

补充法律意见书（二）



二〇二六年六月

**北京市君合律师事务所**  
**关于珠海越亚半导体股份有限公司**  
**首次公开发行（A股）股票并在创业板上市之**  
**补充法律意见书（二）**

**致：珠海越亚半导体股份有限公司**

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”或“君合”）接受珠海越亚半导体股份有限公司（以下简称“越亚半导体”“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人首次公开发行（A股）股票并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的特聘法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发注册管理办法》）《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就本次发行事宜于2025年9月30日出具了《北京市君合律师事务所关于珠海越亚半导体股份有限公司首次公开发行（A股）股票并在创业板上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）《北京市君合律师事务所关于珠海越亚半导体股份有限公司首次公开发行（A股）股票并在创业板上市之法律意见书》（以下简称《法律意见书》），于2025年3月25日出具了《北京市君合律师事务所关于珠海越亚半导体股份有限公司首次公开发行（A股）股票并在创业板上市之补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）等法律文件（《律师工作报告》《法律意见书》与《补充法律意见书（一）》以下合称为“已出具律师文件”）。

因发行人为本次发行上市补充呈报申请文件所使用的财务会计报告期间调整为2023年度、2024年度、2025年度（以下合称“报告期”），容诚会计师于2026年4月28日出具“容诚审字[2026]510Z0238号”《珠海越亚半导体股份有限公司审计报告》（以下简称《审计报告》）。本所律师对发行人在2025年7月1日至2025年12月31日（以下简称“最近一期”）是否存在影响本次发行上市的情形及财务会计报告期间调整后发行人是否符合发行上市的实质条件进行了核查，并出具《北京市君合律师事务所关于珠海越亚半导体股份有限公司首次公开发行（A股）股票并在创业板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

本补充法律意见书是对已出具律师文件的补充，并构成已出具律师文件不可分割的一部分。除有特别说明外，本所在已出具律师文件中发表法律意见的前提、声明、简称、释义和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书所说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

本所律师同意发行人按照中国证券监督管理委员会（以下简称“**中国证监会**”）及深交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行必备的法定文件，随同其他申报材料一同上报，并依法对本补充法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件及本补充法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的有关事实进行了审查和验证，现出具本补充法律意见书。

## 目 录

释 义 .....	6
正 文.....	5
一、 本次发行上市的批准和授权.....	5
二、 本次发行上市的主体资格.....	5
三、 本次发行上市的实质条件.....	5
四、 发行人的设立.....	5
五、 发行人的独立性.....	5
六、 发起人和股东.....	6
七、 发行人的股本及其演变.....	7
八、 发行人的业务.....	7
九、 关联交易及同业竞争.....	9
十、 发行人的主要财产.....	20
十一、 发行人的重大债权债务.....	24
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并.....	27
十三、 发行人章程的制定及修改.....	28
十四、 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	28
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化.....	29
十六、 发行人的税务.....	29
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	33
十八、 发行人募集资金的运用.....	34
十九、 发行人的业务发展目标.....	34
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚.....	34
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价.....	35
二十二、 律师需要说明的其他问题.....	35
二十三、 本次发行的总体结论性意见.....	36
附件一： 专利.....	39

## 释 义

本补充法律意见书中，除非根据上下文另作解释，下列词语或简称具有如下含义：

简称/术语	释义
报告期、最近三年	发行人就申请本次发行而披露的会计报表报告期，即2023年度、2024年度、2025年度
申报基准日	2025年12月31日
《以色列法律意见书》	Shibolet & Co. Advocates & Notaries 于 2026 年 4 月 6 日出具的《法律意见书》
《关于香港越亚的香港法律意见书》	君合律师事务所于 2026 年 4 月 10 日出具的有关越亚封装基板(香港)有限公司的法律意见
《关于香港睿祺的香港法律意见书》	君合律师事务所于 2026 年 4 月 10 日出具的有关香港睿祺投资有限公司的法律意见
《关于美国越亚的尽职调查备忘录》	Jun He Law Offices LLC 根据 Jun He Law Office, P.C. 出具的法律意见于 2026 年 4 月 2 日出具的有关 Access Technologies USA 的特定事项的备忘录
境外法律意见书	提及当时，《以色列法律意见书》《关于香港越亚的香港法律意见书》《关于香港睿祺的香港法律意见书》《关于美国越亚的尽职调查备忘录》的单称或合称
《专利法律意见书》	广州嘉权专利商标事务所有限公司根据美国当地专利代理机构 Buchalter Law Firm、日本当地专利代理机构弁理士法人オリーブ国際特許事務所、韩国代理机构 KNK IP LAW FIRM、以色列代理机构 Fisher-Friedman IP Group、中国台湾当地代理亚律国际专利商标联合事务所、英国代理机构 Venner Shipley LLP 的核查意见，于 2026 年 4 月 15 日出具的关于发行人及其子公司境外专利情况的《关于珠海越亚半导体股份有限公司的境外专利权利情况核查报告》
《审计报告》	容诚于 2026 年 4 月 28 日出具的《珠海越亚半导体股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]510Z0238 号）
《纳税鉴证报告》	容诚于 2026 年 4 月 28 日出具的《珠海越亚半导体股份有限公司主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（容诚专字[2026]510Z0626 号）
《内控报告》	容诚于 2026 年 4 月 28 日出具的《珠海越亚半导体股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2026]510Z0237 号）

注：本律师工作报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

# 正文

## 一、本次发行上市的批准和授权

根据发行人的书面确认及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，已出具律师文件中披露的发行人关于本次发行上市的批准和授权情况未发生变化。

## 二、本次发行上市的主体资格

根据发行人的工商登记材料、现行有效的营业执照、《公司章程》及其书面确认，并经本所律师通过企业公示系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网等网站的公示信息查询，发行人系依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，截至本补充法律意见书出具之日，发行人依法有效存续，不存在根据法律法规和《公司章程》规定需要终止的情形，具备本次发行上市的主体资格。

## 三、本次发行上市的实质条件

本所律师在已出具律师文件中披露了发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《首发注册管理办法》《创业板上市规则》等法律法规规定的申请首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件。

根据《审计报告》《内控报告》《招股说明书》、相关政府主管部门出具的证明、发行人提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，除尚需经深交所发行上市审核并取得中国证监会同意注册的决定，以及发行人股票的上市交易尚需经深交所同意外，发行人本次发行持续符合《公司法》《证券法》《首发注册管理办法》《创业板上市规则》等法律法规规定的申请首次公开发行股票并在创业板上市的各项实质条件。

## 四、发行人的设立

根据发行人的书面确认，截至本补充法律意见书出具之日，已出具律师文件中披露的发行人的设立情况未发生变化。

## 五、发行人的独立性

根据《招股说明书》《审计报告》、发行人提供的资料及其书面确认并经本所

律师核查，就本所律师具备的法律专业知识所能作出的合理判断，截至申报基准日，发行人的资产独立、完整，业务、人员、财务和机构独立于主要股东及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 六、发起人和股东

### （一）发行人的发起人股东

根据《公司章程》《发起人协议》《以色列法律意见书》、发行人的工商登记材料和发行人的书面确认，最近一期，发行人的发起人股东 AMITEC 公司股权结构存在如下变化：

截至《以色列法律意见书》出具之日，AMITEC 公司已发行股本持有人情况如下：

序号	股东名称	股份数目（股）	持股比例
1.	Prioritech 公司	8,277,240 股 A-1 类普通股	74.08%
2.	Ocean Substrates Pte. Ltd.	2,896,617 股 A-2 类普通股	25.92%

根据《以色列法律意见书》，Prioritech 公司是一家注册在以色列的公众有限责任公司（以色列上市公司），其法定注册资本 24,000,000 以色列新谢克尔，划分为 24,000,000 股普通股，每股面值 1 以色列新谢克尔，已发行股本 13,128,180 股（含 1,270,317 休眠股）；截至《以色列法律意见书》出具之日，Prioritech 公司实际控制人 Rafi Amit、Yotam Stern 的持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	普通股数量（股）	持股比例（%）
1.	Rafi Amit	1,262,106	10.64
2.	Yotam Stern	1,316,958	11.11

### （二）发行人的现有股东

1. 根据《关于香港睿祺的香港法律意见书》、发行人及其股东的工商登记材料、发行人的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统的公示信息查询，最近一期，发行人现有股东香港睿祺的基本情况存在变化。

根据《关于香港睿祺的香港法律意见书》，最近一期，香港睿祺办事地址发生变化；截至《关于香港睿祺的香港法律意见书》出具之日，香港睿祺的基本情况如下：

名称	Hong Kong Smart Investment Limited
类型	有限公司
公司编号	1791124
办事地址	Room C, 18/F, Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong
董事	陈先明、陈春灵、Nicholas Patrick Stukan Jr
成立日期	2012.08.24

2. 根据发行人及发行人股东提供的资料及书面确认，并经本所律师核查，截至申报基准日，发行人的股东均依法有效存续，具有法律法规规定担任股份公司股东并向公司出资的资格；发行人最近两年一直无控股股东、无实际控制人，且不存在控制权发生变更的情形；发行人无控股股东、无实际控制人并不影响其治理结构的有效性。

## 七、发行人的股本及其演变

根据发行人的工商登记资料及其书面确认，并经本所律师通过国家企业公示系统、中国执行信息公开网和中国裁判文书网的公示信息查询，最近一期，发行人未发生股份变动；截至申报基准日，发行人的股份不存在被质押或冻结的情形。

## 八、发行人的业务

### （一） 发行人的经营范围和经营方式

根据发行人提供的《公司章程》、工商登记材料、相关董事会和股东（大）会会议文件和其书面确认，并经本所律师通过企业公示系统的公示信息查询，最近一期，发行人的经营范围未发生变化。

根据发行人提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，最近一期，发行人及其境内子公司拥有的与其主营业务相关的经营资质证书未发生变化。

根据发行人及其境内子公司所在地相关主管机关出具的证明文件及发行人的书面确认，并经本所律师核查，截至申报基准日，发行人及其境内子公司的经营范围和主营业务符合有关法律法规的规定，并已取得从事经营业务所必需的资质、政府许可或批准，且该等资质、政府许可或批准合法有效，不存在该等资质、政府许可和批准被撤销、吊销的情形。

## （二）发行人在中国大陆以外的经营活动

根据发行人的书面确认及境外法律意见书，截至本补充法律意见书出具之日，发行人存在两家境外子公司，即香港越亚和美国越亚，其具体情况如下：

### 5.香港越亚

根据《关于香港越亚的香港法律意见书》，截至2026年4月8日，香港越亚在香港有效存续，仍列入香港公司注册处备存的公司登记册，不存在强制性清盘或自愿性清盘的情况。

最近一期内，香港越亚变更了注册办事处地址，变更后的注册办事处地址为 Room C, 18/F, Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong。

### 6.美国越亚

根据《关于美国越亚的尽职调查备忘录》，截至2026年4月2日，美国越亚在美国有效存续，美国越亚并未采取任何行动以启动美国越亚的清算、注销或解散。

## （三）发行人的主营业务

根据《审计报告》《招股说明书》及发行人的书面确认，并经本所律师核查，报告期内，发行人一直从事先进封装关键材料和产品的研发、生产以及销售，主营业务未发生过变更。

根据《审计报告》《招股说明书》，发行人在报告期内的主营业务收入、营业收入、主营业务收入占营业收入的比重情况如下表所示：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
主营业务收入（万元）	199,061.55	171,799.46	164,165.12
营业收入（万元）	208,905.40	179,558.78	170,547.51
主营业务收入占营业收入的比重（%）	95.29	95.68	96.26

据此，本所律师认为，发行人报告期内的业务收入主要来自其主营业务，发行人的主营业务突出。

## （四）发行人的持续经营

根据《公司章程》和发行人的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统的公示信息查询，发行人为永久存续的股份有限公司。根据发行人的书面确认，并

经本所律师通过企业公示系统、中国执行信息公开网和中国裁判文书网的公示信息查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在根据法律法规及《公司章程》规定需要其解散或终止的情形，不存在其主要生产经营性资产被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在现行法律法规禁止或限制其开展目前业务的情形，发行人依照法律的规定在其经营范围内开展经营活动，不存在持续经营的法律障碍。

据此，本所律师认为，发行人不存在影响其持续经营的法律障碍。

## 九、关联交易及同业竞争

### （一）发行人的关联方

根据《公司法》《创业板上市规则》等法律法规的有关规定、《以色列法律意见书》、中国平安2025年年度报告，发行人及其董事、监事、高级管理人员、股东的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统的公开信息查询，截至申报基准日，发行人主要关联方及其关联关系如下：

#### 1.直接持有发行人 5%以上股份的企业或者一致行动人

序号	关联方名称	关联关系
1.	AMITEC 公司	发行人第一大股东，直接持有发行人 39.95%股份
2.	新信产	发行人第二大股东，直接持有发行人 30.91%股份
3.	巨人网盛	新信产一致行动人，持有发行人 6.32%股份
4.	东方富海	持有发行人 2.22%股份
5.	东方富海二号	持有发行人 1.03%股份
6.	皖江物流	持有发行人 2.15%股份
7.	富海新材	持有发行人 2.69%股份
8.	深圳鑫富	持有发行人 1.93%股份
9.	东方富海管理	持有发行人 3.46%股份

互为一致行动人，合计持有发行人 13.48%股份

#### 2.对公司具有直接或间接重大影响的其他关联方

序号	关联方名称	关联关系
<b>一、AMITEC 公司相关关联方</b>		
1.	Prioritech 公司	AMITEC 公司控股股东，发行人的副董事长 Yotam Stern 为该企业的实际控制人之一并担任

序号	关联方名称	关联关系
		该企业的董事、首席执行官
2.	Camtek Ltd.	Priortech 公司直接或间接控制的企业，发行人的副董事长 Yotam Stern 担任该企业的董事
3.	Camtek H.K. Ltd.	Camtek Ltd.直接或间接控制的企业
4.	Camtek USA Inc.	Camtek Ltd.直接或间接控制的企业
5.	Camtek (Europe) NV	Camtek Ltd.直接或间接控制的企业
6.	Camtek Germany GmbH	Camtek Ltd.直接或间接控制的企业
7.	Camtek Inspection Technology (Suzhou) Ltd.	Camtek Ltd.直接或间接控制的企业
8.	Camtek Japan Ltd.	Camtek Ltd.直接或间接控制的企业
9.	Camtek Inspection Technology Limited	Camtek Ltd.直接或间接控制的企业
10.	Camtek South East Asia Pte Ltd.	Camtek Ltd.直接或间接控制的企业
11.	Camtek Korea Ltd.	Camtek Ltd.直接或间接控制的企业
12.	Camtek Germany Holding GmbH	Camtek Ltd.直接或间接控制的企业
13.	FRT GmbH	Camtek Ltd.直接或间接控制的企业
14.	Amitec-Advanced Multilayer Interconnect Technologies HK Limited	Priortech 公司直接或间接控制的企业
15.	Afik (real estate) Limited.	Priortech 公司直接或间接控制的企业，发行人的副董事长 Yotam Stern 担任该企业的董事

## 二、新信产相关关联方

### (一) 直接或间接控制新信产的企业

1.	新方正集团	新信产的控股股东，持有其 100%股权
2.	新方正（北京）企业管理发展有限公司	新方正集团控股股东，持有其 66.51%的股权
3.	中国平安人寿保险股份有限公司	新方正（北京）企业管理发展有限公司的控股股东，持有其 100%的股权
4.	中国平安	中国平安人寿保险股份有限公司的控股股东，持有其 99.51%的股权

### (二) 新信产控制的主要企业（一级子公司）

1.	方正信息产业研究院（苏州）集团有限公司	新信产持有该企业 100%股权
2.	北京方正慧新科技有限公司	新信产持有该企业 100%股权
3.	北京方正数码有限公司	新信产持有该企业 95%股权

序号	关联方名称	关联关系
4.	北京方正信息技术有限公司	新信产持有该企业 100%股权
5.	天津方正启锐科技有限公司	新信产持有该企业 100%股权
6.	方正信息技术（苏州）有限公司	新信产持有该企业 95%股权
7.	上海方正数字出版技术有限公司	新信产持有该企业 100%股权
8.	上海鲸铂信息安全技术有限公司	新信产持有该企业 60%股权
9.	方正移动传媒技术（北京）有限公司	新信产持有该企业 51.77%股权
10.	方正控股有限公司	新信产持有该企业 31.77%股权，发行人的董事徐澄洁担任该企业的执行董事
<b>（三）新信产的控股股东新方正集团控制的主要企业（一级子公司）</b>		
1.	方正商业管理有限责任公司	新方正集团持有该企业 100%股权，发行人的董事长聂志强担任该企业的董事长、总经理
2.	北京北大药业有限公司	新方正集团持有该企业 97.77%股权
3.	江苏方正苏高新港有限公司	新方正集团持有该企业 60%股权
4.	方正商业地产有限责任公司	新方正集团持有该企业 100%股权
5.	北大医疗管理有限责任公司	新方正集团持有该企业 100%股权
6.	方正国际教育咨询有限责任公司	新方正集团持有该企业 100%股权，发行人的董事长聂志强担任该企业的董事长、总经理
7.	方正证券股份有限公司	新方正集团持有该企业 28.71%股权
8.	北大方正人寿保险有限公司	新方正集团持有该企业 51%股权，发行人的董事长聂志强担任该企业的董事
<b>（四）新方正集团的控股股东中国平安控制的主要企业</b>		

注：北京方正信息技术有限公司、天津方正启锐科技有限公司、方正移动传媒技术（北京）有限公司、方正信息技术（苏州）有限公司已进入破产清算程序并由管理人接管。

### 3.发行人的董事、高级管理人员

序号	姓名	关联关系
1.	聂志强	董事长
2.	Yotam Stern	副董事长
3.	LIN-LIN ZHOU（周林林）	董事
4.	梅健	董事
5.	徐澄洁	董事
6.	刘庆国	独立董事
7.	栾依峥	独立董事

序号	姓名	关联关系
8.	沈璟	独立董事
9.	陈先明	职工代表董事、CEO、总经理
10.	陈春灵	财务总监、董事会秘书
11.	罗明	副总经理
12.	张伟	副总经理
13.	谢凤霞	副总经理

4.除前述第 1、2 项之外，截至申报基准日，由前述第 3 项所列示的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织

序号	关联方名称	关联关系
1.	方正国际贸易有限责任公司	发行人的董事长聂志强担任该企业的董事长
2.	中国高科集团股份有限公司 <sup>1</sup>	发行人的董事长聂志强担任该企业的董事长、董事
3.	北京北大科技园建设开发有限公司	发行人的董事长聂志强担任该企业的董事
4.	北京北大科技园有限公司	发行人的董事长聂志强担任该企业的董事
5.	Principle Capital Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）持股 100% 并担任该企业的董事
6.	Asia BB Holding Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）持股 33.3333% 并担任该企业的董事
7.	Asia BB (HK) Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
8.	Principle Capital Advisors Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
9.	Principle Capital Fund IV GP, Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
10.	Taurus 2020 (HK) Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
11.	Asia Refrigeration Holdings Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
12.	Asia Refrigeration Holdings (HK) Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
13.	AI Automation Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
14.	Metalogic Motivation (Hong Kong) Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
15.	Venus 2020 Holding Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
16.	Venus 2020 (HK) Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制

<sup>1</sup> 截至目前聂志强已不在该公司任职。

序号	关联方名称	关联关系
		该企业，并担任该企业的董事
17.	Jupiter 2020 Holding Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
18.	Jupiter 2020 (HK) Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
19.	Principle Capital Fund V GP, Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
20.	Aries 2020 Holding Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
21.	Aries 2020 (HK) Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
22.	Reflex Technology Holding Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
23.	Libra 2022 Holding Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
24.	Mars 2023 Holding Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
25.	Virgo 2023 Holding Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
26.	Mars 2025 Holding Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
27.	Mars Innovation Limited	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业，并担任该企业的董事
28.	Principle Capital Associates IV, L.P.	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业
29.	Principle Capital Fund IV, L.P.	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业
30.	Ocean Semiconductor Co., Ltd	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业
31.	Ocean Semiconductor PTE. LTD.	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业
32.	Ocean Substrates Pte. Ltd.	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业
33.	Principle Capital Associates V, L.P.	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业
34.	Principle Capital Fund V, L.P.	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）实际控制该企业
35.	Akribis Systems Pte Ltd	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）担任该企业的董事
36.	上海谱润股权投资管理有限公司	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）担任该企业的董事长
37.	浙江格励奥纺织股份有限公司	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）担任该企业的董事
38.	上海吉凯基因医学科技股份有限公司	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）担任该企业的董事
39.	天昊基因科技（苏州）有限公司	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）担任该企业的董事

序号	关联方名称	关联关系
40.	浙江星星冷链集成股份有限公司	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）担任该企业的董事
41.	上海百赛生物技术股份有限公司	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）担任该企业的董事
42.	深圳市咖啡能科技有限公司	发行人的董事梅健实际控制该企业，并担任该企业的执行董事、总经理
43.	深圳市成商领航科技有限公司	发行人的董事梅健实际控制该企业，并担任该企业的执行董事
44.	深圳巴蜀企业家俱乐部有限公司	发行人的董事梅健担任该企业的董事
45.	深圳市海纳同创投资有限公司	发行人的董事梅健担任该企业的董事
46.	江苏浩博新材料股份有限公司	发行人的董事梅健担任该企业的董事
47.	深圳市安博瑞新材料科技有限公司	发行人的董事梅健担任该企业的董事
48.	湖南立发釉彩科技有限公司	发行人的董事梅健担任该企业的董事
49.	上海子能高科股份有限公司	发行人的董事梅健担任该企业的董事，该企业已于2010年被吊销
50.	深圳市东斯隆企业管理顾问有限责任公司	发行人的董事梅健担任该企业的董事长，该企业已于2009年被吊销 <sup>2</sup>
51.	方正科技	发行人的董事徐澄洁担任该企业的董事
52.	北京北大方正技术研究院有限公司	发行人的董事徐澄洁担任该企业的经理、董事
53.	北京方正欣远科技有限公司	发行人的董事徐澄洁担任该企业的董事
54.	北京方正智联科技有限公司	发行人的董事徐澄洁担任该企业的董事
55.	北京方正智星科技有限公司	发行人的董事徐澄洁担任该企业的董事
56.	方正电子（香港）有限公司	发行人的董事徐澄洁担任该企业的董事
57.	北京方正印捷数码技术有限公司	发行人的董事徐澄洁担任该企业的董事
58.	北京方正慧新科技有限公司	发行人的董事徐澄洁担任该企业的董事
59.	Qing & Qing Corporation	发行人的独立董事刘庆国担任该企业的创始合伙人
60.	北京益而康生物工程技术有限公司	发行人的独立董事栾依峥担任该企业的董事长
61.	山东益而康生物科技有限公司	发行人的独立董事栾依峥担任该企业的执行董事
62.	华熙医药科技（山东）有限公司	发行人的独立董事栾依峥担任该企业的总经理
63.	瑞吉明（山东）生物科技有限公司	发行人的独立董事栾依峥担任该企业的董事
64.	香港睿祺	发行人的职工代表董事、CEO、总经理陈先明担任该企业的董事，发行人的财务总监、董事会秘书陈

<sup>2</sup> 根据梅健的书面确认，其还担任深圳市东斯隆企业管理顾问有限责任公司的法定代表人，该公司不涉及违法违规情况，梅健本人对该公司的吊销不负有任何个人责任。

序号	关联方名称	关联关系
		春灵担任该企业的董事
65.	珠海睿祺	发行人的财务总监、董事会秘书陈春灵担任该企业的执行事务合伙人

5.除上述主要关联方外，具有下列情形之一的主体，亦为发行人的关联方：

（1）发行人董事及高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；（2）前述第（1）类关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除发行人及发行人控股子公司以外的法人（或其他组织）。

6.过去十二个月内，曾经具有上述第 1 至 5 项情形的自然人、法人或其他组织，以及曾担任发行人监事的自然人

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至申报基准日，过去十二个月内，曾经具有上述第1至5项情形的自然人、法人或其他组织，以及曾担任发行人监事的自然人构成发行人的关联方。

7.其他关联方

除上述已披露关联方外，根据《审计报告》、发行人的书面确认并经本所律师核查，报告期内曾经是发行人的主要关联方或与发行人发生交易的其他关联方情况如下：

序号	关联方名称或姓名	与发行人的关联关系
1.	方正集团	报告期内曾经控制方正信产的企业
2.	平安银行	中国平安控制的企业，该企业报告期内与发行人存在交易
3.	中国平安财产保险股份有限公司	中国平安控制的企业，该企业报告期内与发行人存在交易
4.	方正高密	方正科技持股 74.6096%的企业，该企业报告期内与发行人存在交易
5.	重庆方正高密电子有限公司	方正科技持股 74.9571%的企业，该企业报告期内与发行人存在交易
6.	珠海驰方电子有限公司	方正科技控制的企业，该企业报告期内与发行人存在交易

序号	关联方名称或姓名	与发行人的关联关系
7.	方正多层	发行人报告期内曾经的董事齐子鑫于 2021 年 12 月至 2023 年 5 月担任该企业的董事，方正科技控制该企业，该企业报告期内与发行人存在交易
8.	方正发展	发行人报告期内曾经的董事齐子鑫于 2021 年 12 月至 2023 年 5 月担任该企业的董事，方正科技控制该企业，该企业报告期内与发行人存在交易
9.	方正证券承销保荐有限责任公司	方正证券股份有限公司控制的企业，该企业报告期内与发行人存在交易
10.	苏州康代智能科技股份有限公司	发行人的董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）于 2017 年 9 月至 2022 年 8 月实际控制该企业，2019 年 11 月至 2022 年 8 月担任该企业的董事，该企业报告期内与发行人存在交易
11.	深圳康优软件技术有限公司	苏州康代智能科技股份有限公司直接控制的企业，该企业报告期内与发行人存在交易
12.	芯动科技（北京）有限公司	发行人曾经的监事张昕雨担任该企业的董事
13.	无锡舜铭存储科技有限公司	发行人曾经的监事张昕雨担任该企业的董事
14.	六式格玛半导体科技（深圳）有限公司	发行人曾经的监事张昕雨担任该企业的董事
15.	苏州高博储能科技有限公司	发行人曾经的监事张炜华担任该企业的董事
16.	开翼私募基金管理南通有限公司	发行人曾经的监事张炜华担任该企业的执行董事兼总经理
17.	昆山润石智能科技有限公司	发行人曾经的监事张炜华担任该企业的董事
18.	上海开翼柏源企业管理咨询服务有限公司	发行人曾经的监事张炜华担任该企业的董事兼财务负责人

## （二）关联交易

根据《审计报告》及发行人的书面确认，报告期内发行人与关联方之间存在以下关联交易：

### 1.采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2025 年度 发生额（元）	2024 年度 发生额（元）	2023 年度 发生额（元）
方正高密	加工费	-	11,520.00	15,680.00
	园区公摊服务费	306,489.55	710,040.00	1,280,546.19
	废水站费用	322,139.24	342,967.70	1,644,796.31
	水电费	873,617.17	1,705,070.24	2,498,116.48

关联方	关联交易内容	2025 年度 发生额（元）	2024 年度 发生额（元）	2023 年度 发生额（元）
方正多层	资产转让相关费用	1,369,466.62	-	-
方正发展	服务费	3,495,475.50	5,829,903.15	9,530,958.09
苏州康代智能科技股份有限公司	材料采购	-	-	29,370.00
	维保费	-	-	29,007.00
深圳康优软件技术有限公司	维保费	-	-	197,575.00
中国平安财产保险股份有限公司南通中心支公司	车辆保险费	12,080.03	15,671.77	18,175.46
北京方正数码有限公司	采购工程			485,301.23
珠海驰方电子有限公司	加工费	22,140.00		
方正证券承销保荐有限责任公司	中介机构服务费用	2,000,000.00		

## 2. 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2025 年度 发生额（元）	2024 年度 发生额（元）	2023 年度 发生额（元）
方正高密	外协加工费	333,093.30	900.00	311,678.88
	水电费	1,180,758.96	1,553,605.14	1,609,799.60
	餐饮服务	-	-	8,783.02
方正多层	外协加工费	900.00	2,400.00	-
	餐饮服务	-	-	952.83
方正发展	餐饮服务	-	-	10,141.51
珠海驰方电子有限公司	外协加工费	3,000.00	-	-

## 3. 关联租赁

### （1）发行人作为出租方

序号	承租方	租赁资产种类	2025 年度确认的租赁收入（元）	2024 年度确认的租赁收入（元）	2023 年度确认的租赁收入（元）
1.	方正高密	配电设备	270,748.08	270,748.08	270,748.08

### （2）发行人作为承租方

报告期内，发行人承租方正多层的厂房。

序号	承租方	租赁资产种类	2025 年度支付的租金（元）	2024 年度支付的租金（元）	2023 年度支付的租金（元）
----	-----	--------	-----------------	-----------------	-----------------

序号	承租方	租赁资产种类	2025年度支付的租金(元)	2024年度支付的租金(元)	2023年度支付的租金(元)
1.	方正多层	仓库及配套公用设施	2,017,336.65	3,409,036.00	4,713,832.00

#### 4.其他关联交易

发行人存放于平安银行的活期存款2025年度取得利息收入2,790.71元，购买平安银行的定期存单2025年度取得投资收益118,333.33元，购买结构性存款2025年度取得投资收益30,821.92元，银行手续费2025年度支出386.80元。

公司存放于平安银行的活期存款2024年度取得利息收入1,025.83元，购买平安银行的定期存单2024年度确认投资收益3,550,000.00元，银行手续费2024年度支出4.50元。

公司存放于平安银行的活期存款2023年度取得利息收入1,336.93元，购买平安银行的定期存单2023年度确认投资收益3,550,000.00元。

#### 5.关键管理人员薪酬

项目	2025年度发生额(元)	2024年度发生额(元)	2023年度发生额(元)
关键管理人员报酬	8,905,143.72	8,369,838.33	6,909,370.56

说明：关键管理人员报酬中不包含股份支付费用。

#### 6.关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	平安银行	72,753.21	-	587,478.07	-	592,554.74	-
一年内到期的非流动资产/债权投资	平安银行	-	-	110,531,666.67	-	106,981,666.67	-
应收账款	方正高密	2,131,467.05	21,314.67	2,506,949.12	25,069.49	7,585,442.40	75,854.42
预付款项	方正多层	-	-	426,800.00	-	515,700.00	-
预付款项	方正高密	-	-	11,208.34	-	-	-
预付款项	方正发展	-	-	901,373.61	-	-	-

项目名称	关联方	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	方正高密	118,551.79	5,927.59	197,691.97	9,884.60	209,978.74	10,498.94
其他应收款	方正多层	339.00	16.95	103,228.64	5,161.43	-	-
预付款项	中国平安财产保险股份有限公司	-	-	-	-	3,119.38	-

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应付账款	方正多层	106,600.00	277,036.00	
应付账款	方正发展	817,060.73	-	1,566,312.87
应付账款	方正高密	202,113.03	-	335,158.03
其他应付款	北京方正数码有限公司	357,292.03	357,292.03	846,822.06
租赁负债	方正多层	4,373,796.70	-	1,789,348.26
一年内到期的非流动负债	方正多层	1,148,297.22	1,789,348.26	2,932,319.26
应付账款	珠海驰方电子有限公司	971.80	-	-

### (三) 董事会对2025年度关联交易的审议

2026年4月10日，发行人全体独立董事召开独立董事专门会议，审议并通过《关于确认公司2025年度关联交易事项的议案》，并将上述议案提交至董事会审议。2026年4月10日，发行人召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于确认公司2025年度关联交易事项的议案》。依据该等议案和决议文件：（1）2025年度发行人与关联方之间存在的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则；（2）该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；（3）关联交易事项已经履行了必要的审议程序，程序符合《公司法》《公司章程》和其他的公司制度的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人报告期内的关联交易已经发行人独立董事专门会议、董事会及股东会（如需）审议，关联交易的定价是基于正常的市场交

易条件和市场化原则及进行商业化磋商的基础上进行的，定价公允，对发行人的生产经营不构成重大不利影响。

#### （四） 同业竞争

根据发行人的工商登记材料、《以色列法律意见书》、发行人及其主要股东的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统的公示信息核查，截至申报基准日，发行人的第一大股东 AMITEC 公司及其控股股东和实际控制人、第二大股东新信产及其一致行动人巨人网盛和新方正集团直接或间接控制的企业均不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

#### （五） 发行人对关联交易和同业竞争事项的披露

根据《招股说明书》和发行人的书面确认，《招股说明书》中充分披露了发行人报告期内有关关联交易和避免同业竞争的承诺和措施，无重大遗漏或重大隐瞒。

### 十、 发行人的主要财产

#### （一） 房产

根据发行人提供的不动产权证书、不动产档案查询文件、发行人的书面确认，最近一期，发行人及其境内子公司新增拥有的房产情况如下：

权利人	证书编号	房屋坐落	规划用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	取得 方式	使用期限
发行人	粤(2025)珠海市不动产权第0220354号	珠海市斗门区乾务镇珠峰大道北 3209 号(方正 PCB 废水站)	工业	4,996.01	购买	至 2055.08.11 止

根据发行人的书面确认，并经本所律师查验该等房产的权属证书、不动产档案查询文件，以及本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其境内子公司合法拥有上述及《律师工作报告》正文第十章“发行人的主要财产”所述房产，并已取得相应的权属证书，该等房产不存在产权方面的纠纷；珠海越芯和南通越亚持有的房产虽设置了抵押，但不影响发行人及其境内子公司的正常使用；发行人持有的房产不存在抵押、查封等其他权利措施。

## （二）土地使用权

根据发行人提供的不动产权证书、不动产档案查询文件及其书面确认，最近一期，发行人及其境内子公司新增拥有的土地使用权情况如下：

权利人	证书编号	位置	用途	宗地面积/分摊土地使用面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	使用期限
发行人	粤（2025）珠海市不动产权第 0220354 号	珠海市斗门区乾务镇珠峰大道北 3209 号（方正 PCB 废水站）	工业用地	1,696.49	购买	至 2055.08.11 止

根据发行人的书面确认，并经本所律师查验该等土地使用权的权属证书、不动产档案查询文件，以及本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其境内子公司合法拥有上述及《律师工作报告》正文第十章“发行人的主要财产”所述的土地使用权，并已取得相应的权属证书，该等土地使用权不存在产权方面的纠纷；珠海越芯和南通越亚持有的土地使用权虽设置了抵押，但不影响发行人及其境内子公司的正常使用；发行人持有的土地使用权不存在抵押、查封等他项权利措施。

## （三）知识产权

### 1. 专利

根据发行人提供的境内专利的权属证书及其书面确认、中华人民共和国知识产权局出具的《证明》，并经本所律师通过中国及多国专利审查信息查询网（<https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn>）的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其子公司持有境内专利107项，境内专利具体情况详见本补充法律意见书附件一“专利”之“（一）境内专利”所述，该等境内专利不存在质押等他项权利限制。

根据《专利法律意见书》，截至申报基准日，发行人及其子公司持有境外专利309项，境外专利具体情况详见本补充法律意见书附件一“专利”之“（二）境外专利”所述，该等境外专利不存在质押等他项权利限制。

根据《专利法律意见书》和发行人的书面确认，并经本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其子公司拥有的上述专利不存在产权方面的纠纷。

## 2.注册商标

根据发行人提供的《商标注册证》及其书面确认、商标局出具的关于发行人拥有的商标注册证明，并经本所律师通过中国商标网（<https://cas.sbj.cnipa.gov.cn/cas/>）的公示信息查询，最近一期，发行人及其子公司持有的境内注册商标情况未发生变化。

根据发行人的书面确认，并经本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其子公司拥有的注册商标不存在产权方面的纠纷。

## 3.计算机软件著作权

根据发行人提供的《计算机软件著作权证书》及其书面确认、中国版权保护中心查册文件，并经本所律师通过中国版权保护中心网站（<http://www.ccopyright.com.cn/>）的公示信息查询，最近一期，发行人及其子公司持有的计算机软件著作权情况未发生变化。

根据发行人的书面确认，并经本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权不存在产权方面的纠纷。

### （四）发行人的对外投资情况

根据发行人提供的资料及其书面确认，最近一期发行人无新增子公司；截至申报基准日，发行人拥有3家境内全资子公司、2家境外全资子公司，以及1家境内参股公司。

根据《关于香港越亚的香港法律意见书》《关于美国越亚的法律尽职调查报告》及发行人的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统的公示信息查询，截至申报基准日，发行人上述子公司依法设立并有效存续，发行人持有的上述子公司的股权（份）不存在产权方面的纠纷，亦不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情况。

### （五）租赁物业

根据发行人提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至申报基准日，

发行人及其境内子公司租赁共计1处物业，情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积或间数	实际用途	租赁期限	出租方是否提供产权证	是否办理租赁备案
1.	发行人	方正多层	珠海市斗门区珠峰大道北3209号	26.71平方米仓库（分摊）及产业园配套公用设施	仓库、生产及生活设施	2021.11.01-2026.10.31	是	否

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，上述租赁物业的相关租赁合同未办理租赁备案登记手续。根据《商品房屋租赁管理办法》第14条、第23条的相关规定，租赁合同当事人未能在合同订立后30日内办理房屋租赁备案手续的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。因此，发行人作为合同一方当事人，未能按时办理房屋租赁备案手续，存在被给予行政处罚的风险，但鉴于：（1）《商品房屋租赁管理办法》第23条中将“责令改正”作为给予行政处罚的前置条件，只有在责令改正期间内，依旧未办理租赁房屋备案的，主管机关方可对其给予行政处罚。根据公司的书面确认，如主管机关要求公司办理租赁备案登记的，公司将根据主管机关的要求相应办理备案手续；（2）根据“信用广东”于2026年2月25日出具的发行人《无违法违规证明公共信用信息报告》和发行人的书面确认，并经本所律师通过当地住房和城乡建设局网站（<https://zjj.zhuhai.gov.cn/>）的公示信息查询，发行人在报告期内不存在因违反上述相关规定而受到主管部门处罚的情形；（3）根据《中华人民共和国民法典》第706条的规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力，上述租赁合同已经构成对双方当事人具有约束力的法律文件。根据发行人的书面确认，截至本补充法律意见书出具之日，该等租赁物业合同履行正常，未发生租赁违约的情形。

综上所述，本所律师认为，上述租赁房屋未办理房屋租赁备案手续对发行人的生产经营不构成重大不利影响，不会构成本次发行上市的实质性法律障碍。

## 十一、发行人的重大债权债务

### (一) 重大合同

根据发行人提供的资料，截至申报基准日，发行人及其子公司正在履行的对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的重大合同内容如下：

#### 1、销售合同

根据发行人提供的资料及其书面确认，截至申报基准日，已出具律师文件中发行人及其子公司正在履行的金额在人民币或等值人民币3,000万元以上且对生产、经营活动具有重大影响的重要销售框架协议情况未发生变化。

#### 2、采购合同

根据发行人提供的资料及其书面确认，截至申报基准日，发行人及其子公司正在履行的对生产、经营活动以及资产、负债和权益产生重大影响或金额在人民币或等值人民币3,000万元以上的重要采购框架协议和订单情况如下：

序号	主体	供应商名称	产品类别	合同金额	签订日期/合作期限
1.	越亚半导体	杜邦中国集团有限公司	原材料，以具体订单为准	框架协议	2018.05.26，协议长期有效，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
2.	越亚半导体	Umicore Marketing Services (HK) Ltd.	原材料，以具体订单为准	框架协议	2018.05.26，协议长期有效，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
3.	越亚半导体	珠海镇东有限公司	原材料，以具体订单为准	框架协议	2018.07.26，协议长期有效，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
4.	越亚半导体	Ajinomoto Fine-Techno Co.,Inc.	原材料，以具体订单为准	框架协议	2018.10.12，协议长期有效，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
5.	越亚半导体	上村工业(深圳)有限公司	原材料，以具体订单为准	框架协议	2018.10.24，协议长期有效，直至任一方提前一个月书面通知终止协议
6.	越亚半导体	烟台招金励福贵金属股份有限公司	原材料，以具体订单为准	框架协议	2018.12.14，协议长期有效，直至任一方提前一个月书面通知终止协议

序号	主体	供应商名称	产品类别	合同金额	签订日期/合作期限
7.	越亚半导体	珠海市丹尼尔电子科技有限公司	原材料, 以具体订单为准	框架协议	2019.01.18, 协议长期有效, 直至任一方提前一个月书面通知终止协议
8.	越亚半导体	力森诺科材料(上海)有限公司	原材料, 以具体订单为准	框架协议	2020.11.18, 协议长期有效, 直至任一方提前一个月书面通知终止协议
9.	越亚半导体	力森诺科材料(香港)有限公司	原材料, 以具体订单为准	框架协议	2023.05.28, 协议长期有效, 直至任一方提前一个月书面通知终止协议
10.	越亚半导体	西安建大博林科技有限公司	原材料, 以具体订单为准	框架协议	2021.06.08, 协议长期有效, 直至任一方提前一个月书面通知终止协议
11.	越亚半导体	深圳连群电子有限公司	原材料, 以具体订单为准	框架协议	2022.03.10, 协议长期有效, 直至任一方提前一个月书面通知终止协议
12.	南通越亚	香港凯意技术有限公司	封装设备	432.00 万欧元	2025.01.14
13.	南通越亚	香港凯意技术有限公司	封装设备	440.00 万欧元	2025.05.13

### 3、建设工程施工/承包合同

根据发行人提供的资料及其书面确认, 截至申报基准日, 发行人及其子公司正在履行的金额在 3,000 万元以上的建设施工/承包合同情况如下:

序号	主体	承包方	工程内容	签订日期	合同金额(万元)
1.	南通越亚	南通八建集团有限公司	宿舍楼工程施工	2023.06	4,628.00
2.	南通越亚	中国电子系统工程第四建设有限公司	厂房、变电站土建总承包	2023.11	12,491.58
3.	南通越亚	南通八建集团有限公司	倒班楼精装修工程	2023.11	3,572.15
4.	珠海越芯	中建八局第一建设有限公司	土建工程	2021.11	30,901.29
5.	珠海越芯	广东星能智慧能源有限公司	配电工程	2022.03	5,417.85
6.	珠海越芯	中建八局第一建设有限公司	机电装修工程	2022.03	9,618.00

#### 4、 银行授信合同、借款合同和担保情况

根据发行人提供的资料及其书面确认，截至申报基准日，发行人正在履行中的金额在2,000万元及以上的银行借款、授信合同<sup>3</sup>情况如下：

序号	借款人	贷款银行	合同名称	借款/授信期限	贷款/授信金额 (万元)	增信措施
1.	发行人	工商银行珠海斗门支行	银行承兑协议	2023.05.29-2025.12.31	20,000.00	发行人以其持有的部分设备设置最高额为 5,064 万元的抵押担保 <sup>4</sup>
2.	发行人	招商银行珠海分行	授信协议	2024.01.12-2026.01.11	15,000.00	无
3.	发行人	浦发银行横琴粤澳深度合作区分行	融资额度协议	2024.05.09-2026.05.08	20,000.00	无
4.	发行人	中国银行股份有限公司珠海分行	授信额度协议	2025.07.18-2026.03.03	12,000.00	无
5.	南通越亚	建设银行南通港闸支行、建设银行珠海港支行、浦发银行南通分行	固定资产银团贷款合同	2019.09.25-2027.05.20	53,000.00	发行人为其提供保证担保；南通越亚以其持有的全部土地使用权和房屋设置抵押担保
6.	南通越亚	江苏银行南通分行	最高额综合授信合同	2025.05.10-2026.05.08	5,000.00	发行人为其提供保证担保；南通越亚以保证金提供质押担保
7.	南通越亚	招商银行南通分行	授信协议	2025.04.01-2026.03.31	10,000.00	发行人为其提供保证担保
8.	南通越亚	招商银行南通分行	固定资产借款合同	2025.09.11-2032.09.10	56,000.00	发行人为其提供保证担保
9.	珠海越芯	建设银行珠海市分行	项目融资贷款合同	2022.10.12-2032.10.11	80,000.00	发行人为其提供保证担保；珠海越芯以其持有的全部土地使用权和房屋设置抵押担保

<sup>3</sup> 若本补充法律意见书中已经披露授信合同，则在该授信合同项下的借款合同、承兑合同或其他具有提款性质的合同、协议不再另行单独披露。

<sup>4</sup> 截至申报基准日，相关设备抵押担保已解除。

序号	借款人	贷款银行	合同名称	借款/授信期限	贷款/授信金额 (万元)	增信措施
10.	珠海越芯	中国银行股份有限公司珠海分行	授信额度协议	2025.7.18-2026.4.28	6,000.00	发行人为其提供保证担保
11.	珠海越芯	工商银行珠海斗门支行	银行承兑协议	2025.02.26-2027.12.31	12,000.00	发行人为其提供保证担保
12.	珠海越芯	上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	融资额度协议	2025.05.09-2026.05.08	10,000.00	发行人为其提供保证担保

## (二) 重大侵权之债

根据《审计报告》、发行人的书面确认、发行人及其境内子公司所在地主管部门出具的证明文件,并经本所律师核查,发行人于报告期内不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

## (三) 发行人与关联方的重大债权债务关系及担保情况

根据《审计报告》、发行人提供的资料及其书面确认,截至申报基准日,除本补充法律意见书正文第九章“关联交易及同业竞争”中披露的发行人与关联方之间的关联交易外,发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系,发行人不存在为关联方提供担保的情形。

## (四) 其他应收款、其他应付款的情况

根据《审计报告》及发行人的书面确认,截至申报基准日,发行人金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的生产经营活动发生,合法有效。

## 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

### (一) 发行人已进行的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的书面确认并经本所律师核查,发行人自设立以来未发生过合并、分立、减少注册资本和重大收购或出售资产的行为。

### (二) 发行人拟进行的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的书面确认,截至本补充法律意见书出具之日,发行人无资产置换、资产剥离、资产出售或其他资产收购计划。

### 十三、 发行人章程的制定及修改

#### （一） 发行人章程的制定及修改

根据发行人提供的资料及其书面确认，并经本所律师的核查，最近一期，发行人《公司章程》未进行修改。

#### （二） 发行人《公司章程》的内容

根据《公司章程》及发行人的书面确认，并经本所律师核查，发行人现行有效的《公司章程》是根据《公司法》等法律法规规定起草和制定的，《公司章程》的内容符合现行法律法规的规定。

#### （三） 本次发行上市后适用的公司章程

为本次发行上市之目的，发行人于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，会议审议通过了发行人在本次发行上市后适用的《公司章程(草案)》。

根据《公司章程（草案）》及发行人的书面确认，并经本所律师核查，发行人制定的《公司章程（草案）》依据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规的规定，《公司章程（草案）》的内容符合现行法律法规的规定，自发行人本次发行上市之日起，即构成规范公司和公司股东、董事、高级管理人员权利义务的、具有法律约束力的合法文件。

### 十四、 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

本所律师已在已出具律师文件披露发行人的组织机构及股东会、董事会的议事规则情况。根据发行人的书面确认并经本所律师核查，最近一期，发行人的组织机构及发行人股东会、董事会的议事规则未发生变化。

经审阅最近一期发行人历次股东会、董事会的会议文件，本所律师认为，发行人最近一期历次股东会、董事会的召开、决议内容及表决程序均合法、合规、真实、有效。

根据发行人提供的资料及其的书面确认，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人最近一期股东会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

## 十五、 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格符合法律、法规和规范性文件以及发行人《公司章程》的规定；最近一期发行人的董事、高级管理人员未发生变更。

根据发行人提供的相关资料及其书面确认，并经本所律师核查，报告期内发行人独立董事任职资格和职权范围符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 十六、 发行人的税务

### （一） 发行人及其境内子公司的主要税种、税率

根据《审计报告》《纳税鉴证报告》及发行人的书面确认，并经本所律师核查，截至申报基准日，发行人及其境内子公司适用的主要税种和税率如下表所示：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入	3、5、6、9、13
城市维护建设税	应纳流转税税额	7
教育费附加	应纳流转税税额	3
地方教育费附加	应纳流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15、25

发行人及其境内子公司企业所得税税率情况说明：

公司名称	企业所得税税率（%）		
	2025 年	2024 年	2023 年
越亚半导体	15	15	15
南通越亚	15	15	15
珠海越芯	25	25	25
越亚科技	25	25	不适用

综上所述，本所律师认为，截至申报基准日，发行人及其境内子公司执行的主要税种、税率符合现行法律法规的规定。

### （二） 发行人及其境内子公司享受的税收优惠

#### 1. 企业所得税优惠

发行人于2023年12月28日被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局

局广东省税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为：GR202344002873，有效期三年。因此，根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，发行人在报告期内享受国家重点扶持的高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税减按15%征收。

南通越亚于2023年11月6日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为：GR202332006449，有效期三年。因此，根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，南通越亚在报告期内享受国家重点扶持的高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税减按15%征收。

## 2. 增值税

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第43号）的规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。发行人2023年享受该增值税优惠政策；南通越亚报告期内适用该增值税优惠政策。

根据财政部、税务总局《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税[2023]17号）、工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、税务总局《关于2023年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作有关要求的通知》（工信部联电子函[2023]228号）的规定，发行人2024年至2025年享受集成电路企业可抵扣进项税额加计15%抵减的优惠政策，珠海越芯2023年至2025年11月享受集成电路企业可抵扣进项税额加计15%抵减的优惠政策。

综上所述，本所律师认为，发行人及其境内子公司在报告期内享受的前述税收优惠合法、合规、真实、有效。

### （三）发行人及其子公司报告期内享受的财政补贴

根据《审计报告》《招股说明书》、发行人提供的其报告期内取得财政补贴的政策依据、收款凭证及其书面确认，并经本所律师核查，发行人及其境内子公司报告期内取得的金额达到100万元以上的财政补贴情况如下：

1. 报告期内，发行人与资产相关的财政补贴具体情况如下：

序号	补贴项目	2025年度 (万元)	2024年度 (万元)	2023年度 (万元)	政策依据
1.	2018年技术改造事后奖补	99.74	123.66	135.69	《广东省经济和信息化委 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 广东省统计局关于印发广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则的通知》(粤经信技改[2015]439号)、《广东省经济和信息化委、广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 广东省统计局关于印发广东省工业企业技术改造事后奖补工作指引的通知》(粤经信技[2015]490号)、珠海市科技和工业信息化局《2018年广东省工业企业技术改造事后奖补珠海市项目公示通告》(珠科工信[2018]1550号)
2.	2017年广东省工业企业技术改造事后奖补	51.48	63.52	69.30	《广东省经济和信息化委 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 广东省统计局关于印发广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则的通知》(粤经信技改[2015]439号)、珠海市科技和工业信息化局《2017年广东省工业企业技术改造事后奖补珠海市项目公示》(珠科工信[2017]1015号)
3.	珠海市工信局信息技术产业发展资金	180.94	180.94	180.94	珠海市工业和信息化局《关于2019年珠海市级技术改造与技术创新资金(支持企业有效投资专题)公示的通告》、珠海市工业和信息化局《关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金(新一代信息技术和产业发展)电子信息产业项目资金计划的通知》(珠工信[2021]43号)
4.	排污补贴	58.28	58.28	58.28	《越亚半导体项目投资合作协议之补充协议》
5.	产业扶持资金补助	126.46	126.46	126.46	《越亚半导体项目投资合作协议》《越亚半导体项目投资合作协议有关条款之补充说明》
6.	南通越亚一期产业扶持资金设备补贴奖励	233.08	311.33	131.22	《越亚半导体项目投资合作协议》
7.	2024年广东省先进制造业发展专项资金	81.90	49.01	-	珠海市工业和信息化局《关于2024年广东省先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)拟支持项目的公示》

2.报告期内，发行人与收益相关的财政补贴具体情况如下：

序号	补贴项目	2025 年度 (万元)	2024 年度 (万元)	2023 年度 (万元)	政策依据
1.	促进集成电路产业发展企业补贴	-	-	160	珠海市工业和信息化局《关于组织开展 2021 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（促进集成电路发展）项目入库的通知》、珠海市工业和信息化局《关于下达 2022 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项（促进集成电路产业发展用途）第二批项目市级财政资金的通知》（珠工信[2022]179 号）
2.	2022 年区服务制造业有序用电项目企业补贴	-	-	108	珠海市斗门区科技和工业信息化局（珠海市斗门区商务局）《关于申报斗门区服务制造业有序用电资金的通知》
3.	总部企业经营贡献奖	-	-	131.09	《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市加强总部企业发展实施办法的通知》（珠府办函[2018]308 号）
4.	单项冠军政府补贴	-	63.2	120	珠海市工业和信息化局《关于下达 2022 年国家级制造业单项冠军企业奖补资金的通知》

综上所述，本所律师认为，发行人及其境内子公司享受的上述财政补贴均取得了地方政府及相关部门的批准，该等补贴事项合法、合规、真实、有效。

#### （四）发行人报告期内的税务合规情况

根据“信用广东”于2026年2月25日出具的发行人《无违法违规证明公共信用信息报告》，及国家税务总局珠海市斗门区税务局于2026年1月18日出具的《无欠税证明》（珠斗税无欠税证[2026]321号），发行人自2023年1月1日至2026年1月15日期间无税收违法违章记录、无欠税的情形。

根据南通市公共信用信息中心于2026年1月19日出具的南通越亚《南通市企业专用信用报告》（有无违法违规记录证明2026年版），及国家税务总局南通市崇川区税务局于2026年1月15日开具的《无欠税证明》（通税崇川无欠税证[2026]455号），南通越亚自2023年1月1日至2026年1月15日期间无违法违规记录、无欠税的情形。

根据“信用广东”于2026年2月25日出具的珠海越芯《无违法违规证明公共信用信息报告》，及国家税务总局珠海市斗门区税务局于2026年1月15日出具的《无欠税证明》（珠斗税无欠税证[2026]288号），珠海越芯自2023年1月1日至2026年1月15日期间无税收违法违章记录、无欠税的情形。

根据“信用广东”于2026年2月25日出具的越亚科技《无违法违规证明公共信用信息报告》，及国家税务总局珠海市斗门区税务局于2026年1月15日出具的《无欠税证明》（珠斗税无欠税证[2026]289号），越亚科技自2024年11月21日至2026年1月15日期间无税收违法违章记录、无欠税的情形。

根据《关于香港越亚的香港法律意见书》，截至2026年4月8日，香港越亚未发现存在有应付但尚未清缴税项或任何公司因税务原因而需缴付的任何处罚、罚金或利息。

根据《关于美国越亚的尽职调查备忘录》，截至2026年4月2日，美国越亚不存在未付或逾期的联邦、州、地方或工资税款扣押权登记；基于董事声明函，没有针对公司的涉及税务事宜的未决或潜在的诉讼、政府调查、传票、主张或任何形式的行为。

根据发行人的书面确认、《关于香港越亚的香港法律意见书》《关于美国越亚的尽职调查备忘录》、发行人及其境内子公司所在地税务主管部门出具的证明文件，并经本所律师通过中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，发行人及子公司报告期内不存在因严重违反税收方面的法律法规而受到主管税务部门行政处罚的情形。

## 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

### （一）发行人的环境保护

根据“信用广东”出具的《无违法违规证明公共信用信息报告》以及南通市公共信用信息中心出具的南通越亚《南通市企业专用信用报告（有无违法违规记录证明 2026 年版）》、发行人的书面确认，并经本所律师通过发行人及境内子公司主要经营地环境保护局官方网站（珠海市生态环境局：<http://ssthjj.zhuhai.gov.cn/>；南通市生态环境局：<http://hbj.nantong.gov.cn/>）、中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，发行人及其境内子公司最近一期不存在因违反环保方面法律、法规和规范性文件而受到环保部门处罚的情形。

### （二）发行人的产品质量和技术监督标准

根据“信用广东”出具的《无违法违规证明公共信用信息报告》、南通市公共信用信息中心出具的南通越亚《南通市企业专用信用报告（有无违法违规记录

证明 2026 年版)》、发行人的书面确认，并经本所律师通过企业公示系统及中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，发行人及境内子公司最近一期不存在因违反有关质量和技术监督方面的法律法规的规定而受到行政处罚的情形。

## 十八、 发行人募集资金的运用

根据《招股说明书》和发行人的书面确认，最近一期，已出具律师文件中披露的发行人募集资金的运用情况未发生变化。

## 十九、 发行人的业务发展目标

根据《招股说明书》和发行人的书面确认，截至本补充法律意见书出具之日，已出具律师文件中披露的发行人的业务发展目标未发生变化。

## 二十、 诉讼、仲裁或行政处罚

### (一) 发行人及其子公司的情况

#### 1. 发行人及其子公司的行政处罚情况

根据《审计报告》、发行人及其境内子公司所在地主管部门出具的证明文件、发行人提供的行政处罚决定书及罚款缴纳凭证、《关于香港越亚的香港法律意见书》《关于美国越亚的尽职调查备忘录》、发行人的书面确认，并经本所律师通过中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，最近一期发行人及其子公司不存在受到行政处罚的情况。

#### 2. 发行人及其子公司的重大诉讼和仲裁情况

根据《审计报告》《关于香港越亚的香港法律意见书》《关于美国越亚的尽职调查备忘录》、发行人的书面确认，并经本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁情况。

### (二) 持有发行人 5%以上股份股东的情况

根据《以色列法律意见书》、持有发行人5%以上股份股东的书面确认，并经本所律师通过中国裁判文书网、中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，截至申报基准日，持有发行人5%以上股份的股东在中国境内不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况。

### **(三) 发行人董事长、总经理的情况**

根据发行人董事长、总经理的无犯罪记录证明、书面确认，并经本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网、中国市场监管行政处罚文书网的公示信息查询，截至申报基准日，发行人董事长、总经理在中国境内不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况。

**(四) 本所律师对已经存在的诉讼、仲裁的调查和了解受到下列因素的限制：**

3.本所律师的判断是基于确信上述各方所作出的书面确认以及有关证言证据是按照诚实和信用的原则作出的。

4.根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，基于目前中国法院、仲裁机构的案件受理程序和公告体制限制，本所律师对于发行人及其控股子公司、持股5%以上的股东、发行人的董事长、总经理已经存在的重大法律诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽。鉴于此，本所律师对于发行人及其境内控股子公司、持有发行人5%以上股份的股东、发行人董事长、总经理已经存在的诉讼、仲裁及行政处罚案件的核查尚无法穷尽。

## **二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价**

本所律师未参与编制《招股说明书》，但就《招股说明书》所涉及的相关法律问题与发行人及保荐机构进行了讨论。本所律师已审阅《招股说明书》及其摘要中引用本补充法律意见书相关内容。本所律师认为，《招股说明书》及其摘要不会因所引用的本补充法律意见书内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **二十二、 律师需要说明的其他问题**

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，涉及发行人的本次发行上市前制定，并准备在本次发行上市后实施的期权激励计划、股东特殊权利如《律师工作报告》第二十二章“律师认为需要说明的其他问题”所述，相关情况未发生变化。最近一期，发行人社保、住房公积金相关情况存在如下变化：

### **(一) 社会保险**

根据发行人提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，2025年度期末发

行人及其子公司社会保险的缴纳情况如下：

时间	员工数量 (人)	缴纳人数 (人)	缴纳人数 占比	差异人数 (人)	差异原因
2025 年度 末	2,420	2,407	99.46%	11	新入职员工在统计当月尚未 办妥社保缴费手续
				2	境外员工无需缴纳社会保险

根据发行人的书面确认、信用广东网站开具的《无违法违规证明公共信用信息报告》，报告期内未发现越亚半导体、珠海越芯、越亚科技在税务（含社保缴纳）领域以及在人力资源社会保障领域存在违法违规行为记录。根据发行人的书面确认、南通市公共信用信息中心出具的《南通市企业专用信用报告》，南通越亚报告期内在人力资源和社会保障领域无违法违规记录信息。

## （二） 住房公积金

根据发行人提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，2025年度末发行人及其子公司住房公积金的缴纳情况如下：

时间	员工数量 (人)	缴纳人数 (人)	缴纳人数占比	差异人数 (人)	差异原因
2025 年度 末	2,420	2,404	99.34%	11	新入职员工在统计当月 尚未办妥住房公积金缴 费手续
				2	境外员工无需缴纳住房 公积金
				3	部分员工在缴纳当月离 职，尚未办妥离职手续

根据发行人的书面确认、信用广东网站开具的《无违法违规证明公共信用信息报告》，报告期内越亚半导体、珠海越芯、越亚科技在住房公积金领域不存在违法违规行为记录。根据发行人的书面确认和南通市住房公积金管理颍川区办事处出具的《住房公积金缴纳证明》，2025年度南通越亚能正常缴存住房公积金，不存在因住房公积金缴存事宜被追缴或被处罚的情形。

## 二十三、 本次发行的总体结论性意见

综上所述，发行人具备申请本次发行的主体资格，本次发行符合《证券法》

《公司法》《首发注册管理办法》《创业板上市规则》等有关法律法规规定的实质条件；《招股说明书》及其摘要引用《律师工作报告》《法律意见书》及本补充法律意见书的内容适当；本次发行尚待深交所发行上市审核并取得中国证监会同意注册的决定，发行人股票的上市交易尚需经深交所同意。

本补充法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

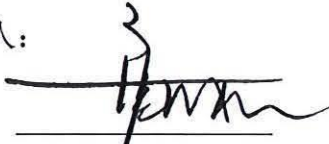
(本页无正文,为《北京市君合律师事务所关于珠海越亚半导体股份有限公司首次公开发行(A股)股票并在创业板上市之补充法律意见书(二)》的签字页)

北京市君合律师事务所

(公章)



负责人:

  
华晓军 律师

经办律师:

  
张慧丽 律师

  
魏狄轩 律师

2026年6月14日

## 附件一：专利

### （一）境内专利

序号	专利名称	类型	权利人	注册号	申请日期	到期日	取得方式	他项权利
1	多层无芯支撑结构及其制作方法	发明	发行人	200710105226.8	2007.05.24	2027.05.23	继受取得	无
2	新型集成电路支撑结构及其制作方法	发明	发行人	200680046501.7	2006.10.15	2026.10.14	继受取得	无
3	具有全厚度同轴结构的多层电子结构	发明	发行人	201310068233.0	2013.03.04	2033.03.03	原始取得	无
4	具有一体化结构组件的多层电子支撑结构	发明	发行人	201310067962.4	2013.03.04	2033.03.03	原始取得	无
5	具有一体化阶梯状堆叠结构的多层电子结构	发明	发行人	201310068669.X	2013.03.04	2033.03.03	原始取得	无
6	具有一体化金属芯的多层电子支撑结构	发明	发行人	201310067885.2	2013.03.04	2033.03.03	原始取得	无
7	具有一体化法拉第屏蔽的多层电子结构	发明	发行人	201310067851.3	2013.03.04	2033.03.03	原始取得	无
8	具有新型传输线的多层电子结构	发明	发行人	201310068125.3	2013.03.04	2033.03.03	原始取得	无
9	具有阶梯状孔的多层电子结构	发明	发行人	201310068024.6	2013.03.04	2033.03.03	原始取得	无
10	具有在平面内方向上延伸的一体化通孔的多层电子结构	发明	发行人	201310065165.2	2013.02.28	2033.02.27	原始取得	无
11	多层电子支撑结构的层间对准	发明	发行人	201310068406.9	2013.03.04	2033.03.03	原始取得	无
12	嵌入在聚合物电介质中的薄膜电容器	发明	发行人	201410081144.4	2014.03.06	2034.03.05	原始取得	无
13	具有嵌入式滤波器的多层电子结构	发明	发行人	201410029604.9	2014.01.22	2034.01.21	原始取得	无
14	单层无芯基板	发明	发行人	201310157191.8	2013.04.28	2033.04.27	原始取得	无
15	嵌入式芯片的制造方法	发明	发行人	201410478551.9	2014.09.18	2034.09.17	原始取得	无
16	具有突出的铜端子柱的基板	发明	发行人	201410336713.5	2014.07.15	2034.07.14	原始取得	无
17	在芯片和基板之间的新型端接和连接	发明	发行人	201410080786.2	2014.03.06	2034.03.05	原始取得	无

序号	专利名称	类型	权利人	注册号	申请日期	到期日	取得方式	他项权利
18	具有电介质厚度改进控制的多层电子结构	发明	发行人	201310157155.1	2013.04.28	2033.04.27	原始取得	无
19	具有超细间距倒装芯片凸点的基板	发明	发行人	201410336766.7	2014.07.15	2034.07.14	原始取得	无
20	薄膜体声波共振器滤波器的制造方法	发明	发行人	201510901507.9	2015.12.08	2035.12.07	原始取得	无
21	具有矩形空腔阵列的聚合物框架的制造方法	发明	发行人	201510885569.5	2015.12.03	2035.12.02	原始取得	无
22	薄膜体声波共振器滤波器	发明	发行人	201510901483.7	2015.12.08	2035.12.07	原始取得	无
23	嵌入式封装	发明	发行人	201710051106.8	2017.01.23	2037.01.22	原始取得	无
24	端子	发明	发行人	201710021398.0	2017.01.12	2037.01.11	原始取得	无
25	一种散热嵌埋封装方法	发明	发行人	202010570659.6	2020.06.22	2040.06.21	原始取得	无
26	一种双面开窗封装结构及其制造方法	发明	发行人	202011258854.1	2020.11.12	2040.11.11	原始取得	无
27	一种无特征层结构的转接载板及其制造方法	发明	发行人	202010536963.9	2020.06.12	2040.06.11	原始取得	无
28	一种临时承载板及使用其制造无芯基板的方法	发明	发行人	202010592220.3	2020.06.24	2040.06.23	原始取得	无
29	一种具有定向光电传输通道的空腔基板及其制造方法	发明	发行人	202010912209.0	2020.09.02	2040.09.01	原始取得	无
30	芯片封装	发明	发行人	201610191287.X	2016.03.29	2036.03.28	原始取得	无
31	一种具有围坝的封装结构及其制造方法	发明	发行人	202011235681.1	2020.11.09	2040.11.08	原始取得	无
32	一种实现多面互连的连接器及其制造方法	发明	发行人	202010911278.X	2020.09.02	2040.09.01	原始取得	无
33	一种集成电路封装方法及封装结构	发明	发行人	201811401821.0	2018.11.22	2038.11.21	原始取得	无
34	电容电感嵌埋结构及其制作方法和基板	发明	发行人	202010553554.X	2020.06.17	2040.06.16	原始取得	无
35	多层基板及其制作方法	发明	发行人	202010551905.3	2020.06.17	2040.06.16	原始取得	无
36	一种具有高效散热结构的封装基板及其制造方法	发明	发行人	202010546656.9	2020.06.15	2040.06.14	原始取得	无
37	实现立体封装的基板制作方法	发明	发行人	202011433687.X	2020.12.10	2040.12.09	原始取得	无
38	具有埋磁电感结构的封装基板及其制作方法	发明	发行人	202011182853.3	2020.10.29	2040.10.28	原始取得	无

序号	专利名称	类型	权利人	注册号	申请日期	到期日	取得方式	他项权利
39	任意方向自由路径阶梯通孔、基板及通孔结构的制作方法	发明	发行人	202110628543.8	2021.06.07	2041.06.06	原始取得	无
40	一种嵌埋结构及制备方法、基板	发明	发行人	202010847366.8	2020.08.21	2040.08.20	原始取得	无
41	封装基板及其制作方法	发明	发行人	202010667146.7	2020.07.13	2040.07.12	原始取得	无
42	主被动器件垂直叠层嵌埋封装结构及其制作方法	发明	发行人	202110816260.6	2021.07.20	2041.07.19	原始取得	无
43	支撑框架结构及其制作方法	发明	发行人	202010599238.6	2020.06.28	2040.06.27	原始取得	无
44	芯片封装结构及其制作方法	发明	发行人	202010788303.X	2020.08.07	2040.08.06	原始取得	无
45	集成电感的嵌埋支撑框架、基板及其制作方法	发明	发行人	202110241375.7	2021.03.04	2041.03.03	原始取得	无
46	芯片封装结构及其制作方法	发明	发行人	202010788908.9	2020.08.07	2040.08.06	原始取得	无
47	一种嵌入式封装基板的制造方法	发明	发行人	202010677083.3	2020.07.14	2040.07.13	原始取得	无
48	一种支撑框架及其制造方法	发明	发行人	202011166007.2	2020.10.27	2040.10.26	原始取得	无
49	封装框架及其制作方法和基板	发明	发行人	202010740053.2	2020.07.28	2040.07.27	原始取得	无
50	集成无源器件封装结构及其制作方法和基板	发明	发行人	202010609666.2	2020.06.29	2040.06.28	原始取得	无
51	具有天线的封装结构及其制作方法	发明	发行人	202110158558.2	2021.02.05	2041.02.04	原始取得	无
52	散热兼电磁屏蔽嵌埋封装结构及其制作方法和基板	发明	发行人	202010546032.7	2020.06.16	2040.06.15	原始取得	无
53	封装基板制作方法	发明	发行人、安世有限公司	202110715575.1	2021.06.28	2041.06.27	原始取得	无
54	一种具有屏蔽腔的嵌入式封装结构及其制造方法	发明	发行人	202010791224.4	2020.08.07	2040.08.06	原始取得	无
55	嵌埋电感结构及其制造方法	发明	发行人	202111530043.7	2021.12.08	2041.12.07	原始取得	无
56	一种金属框架封装基板及其制造方法	发明	发行人	202110009078.X	2021.01.05	2041.01.04	原始取得	无
57	封装结构及其制作方法	发明	发行人	202210232068.7	2022.03.04	2042.03.03	原始取得	无
58	一种双面互联嵌入式芯片封装结构及其制造方法	发明	发行人	202111410151.0	2021.11.18	2041.11.17	原始取得	无

序号	专利名称	类型	权利人	注册号	申请日期	到期日	取得方式	他项权利
59	芯片封装结构制作方法和芯片封装结构	发明	发行人	202110133880.X	2021.02.01	2041.01.31	原始取得	无
60	一种多器件分次嵌埋封装基板及其制造方法	发明	发行人	202110533782.5	2021.05.14	2041.05.13	原始取得	无
61	一种高散热混合基板制作方法及半导体结构	发明	发行人	202211081914.6	2022.09.06	2042.09.05	原始取得	无
62	一种嵌埋器件封装基板及其制作方法	发明	发行人	202210945044.6	2022.08.08	2042.08.07	原始取得	无
63	具有导通柱和内埋线路的基板及其制作方法	发明	发行人	202110482333.2	2021.04.30	2041.04.29	原始取得	无
64	循环冷却嵌埋封装基板及其制作方法	发明	发行人	202110763517.6	2021.07.06	2041.07.05	原始取得	无
65	封装基板及其制作方法	发明	发行人	202210183253.1	2022.02.25	2042.02.24	原始取得	无
66	用于封装基板的烘烤治具及烘烤设备	发明	发行人	202210368223.8	2022.03.30	2042.03.29	原始取得	无
67	芯片背面连接的封装基板及其制作方法	发明	发行人	202210089763.2	2022.01.25	2042.01.24	原始取得	无
68	一种具有空气谐振腔的嵌埋封装结构的制造方法	发明	南通越亚	202010567865.1	2020.06.19	2040.06.18	原始取得	无
69	一种埋芯流程后置的集成电路封装方法及封装结构	发明	南通越亚	201811401833.3	2018.11.22	2038.11.21	原始取得	无
70	一种嵌入式器件封装基板及其制造方法	发明	南通越亚	202010544120.3	2020.06.15	2040.06.14	原始取得	无
71	一种嵌入式封装结构及其制造方法	发明	南通越亚	202010778619.0	2020.08.05	2040.08.04	原始取得	无
72	一种嵌埋在玻璃介质中的无源器件结构及其制造方法	发明	南通越亚	202010819722.5	2020.08.14	2040.08.13	原始取得	无
73	临时承载板及其制作方法和封装基板的制造方法	发明	南通越亚	202110245694.5	2021.03.05	2041.03.04	原始取得	无
74	蒸发架及蒸发装置	发明	南通越亚	202211072117.1	2022.09.02	2042.09.01	原始取得	无
75	一种嵌埋封装结构及其制造方法	发明	南通越亚	202110294274.6	2021.03.19	2041.03.18	原始取得	无
76	一种实现芯片互连封装结构及其制作方法	发明	珠海越芯	202210830138.9	2022.07.15	2042.07.14	原始取得	无
77	框架基板的制作方法及其封装方法	发明	珠海越芯	202510289338.1	2025.03.11	2045.03.10	原始取得	无
78	一种散热嵌埋封装结构	实用新型	发行人	202021171406.3	2020.06.22	2030.06.21	原始取得	无
79	一种微波等离子装置	实用新型	发行人	202022070296.8	2020.09.18	2030.09.17	原始取得	无

序号	专利名称	类型	权利人	注册号	申请日期	到期日	取得方式	他项权利
80	具有贯穿开窗的基板及器件封装结构	实用新型	发行人	202021828720.4	2020.08.27	2030.08.26	原始取得	无
81	刻蚀治具、辅助上料盘及刻蚀治具组件	实用新型	发行人	202022293468.8	2020.10.15	2030.10.14	原始取得	无
82	实现立体封装的基板结构	实用新型	发行人	202022940561.3	2020.12.10	2030.12.09	原始取得	无
83	一种可感应温度的水循环系统	实用新型	发行人	202120391833.0	2021.02.20	2031.02.19	原始取得	无
84	应用于芯片贴装的载具	实用新型	发行人	202120174681.9	2021.01.21	2031.01.20	原始取得	无
85	用于 PCB 板中转的工装	实用新型	发行人	202120889168.8	2021.04.27	2031.04.26	原始取得	无
86	一种无芯封装基板水平架空治具	实用新型	发行人	202120764671.0	2021.04.14	2031.04.13	原始取得	无
87	一种抽真空装置及其真空转换阀	实用新型	发行人	202120355156.7	2021.02.08	2031.02.07	原始取得	无
88	手持真空吸盘	实用新型	发行人	202022998935.7	2020.12.11	2030.12.10	原始取得	无
89	电路板显影治具	实用新型	发行人	202121318242.7	2021.06.11	2031.06.10	原始取得	无
90	封装基板	实用新型	发行人、安世有限公司	202121448060.1	2021.06.28	2031.06.27	原始取得	无
91	一种电镀装置	实用新型	发行人	202121957901.1	2021.08.19	2031.08.18	原始取得	无
92	立体埋嵌封装结构	实用新型	发行人	202122599579.6	2021.10.27	2031.10.26	原始取得	无
93	挠性嵌埋封装基板	实用新型	发行人	202122963357.8	2021.11.29	2031.11.28	原始取得	无
94	用于水平线的无芯封装基板架空治具	实用新型	发行人	202122693023.3	2021.11.04	2031.11.03	原始取得	无
95	封装基板、集成模块和电子设备	实用新型	发行人	202220874771.3	2022.04.08	2032.04.07	原始取得	无
96	封装基板	实用新型	发行人	202220611545.6	2022.03.18	2032.03.17	原始取得	无
97	基板化学镀挂具	实用新型	发行人	202223471933.8	2022.12.22	2032.12.21	原始取得	无
98	封装基板及集成模块	实用新型	发行人	202320211400.1	2023.02.14	2033.02.13	原始取得	无
99	板料取放机构及电镀生产线	实用新型	南通越亚	202220293883.X	2022.02.14	2032.02.13	原始取得	无
100	自动取放板拉伸工装治具及线路板生产线	实用新型	南通越亚	202220296069.3	2022.02.14	2032.02.13	原始取得	无

序号	专利名称	类型	权利人	注册号	申请日期	到期日	取得方式	他项权利
101	翻板传送装置	实用新型	南通越亚	202221792438.4	2022.07.12	2032.07.11	原始取得	无
102	切膜装置	实用新型	南通越亚	202221885634.6	2022.07.20	2032.07.19	原始取得	无
103	PCB 载板安装架	实用新型	南通越亚	202222063344.X	2022.08.05	2032.08.04	原始取得	无
104	真空压膜机用降温装置及真空压膜系统	实用新型	南通越亚	202222293255.4	2022.08.30	2032.08.29	原始取得	无
105	显影线输送装置	实用新型	南通越亚	202320375074.8	2023.03.01	2033.02.29	原始取得	无
106	一种无接触水平线传送结构	实用新型	南通越亚	202320620654.9	2023.03.23	2033.03.22	原始取得	无
107	高导热嵌埋结构	实用新型	南通越亚	202322013767.5	2023.07.28	2033.07.27	原始取得	无

(二) 境外专利

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
美国							
1.	Integrated circuit support structures and their fabrication	发明	US7635641B2	2005.10.17	发行人	2027.04.15	继受取得
2.	Advanced multilayer coreless support structures and method for their fabrication	发明	US7682972B2	2006.06.01	发行人	2027.02.26	继受取得
3.	Coreless cavity substrates for chip packaging and their fabrication	发明	US7669320B2	2007.04.19	发行人	2028.03.20	继受取得
4.	Multilayer Electronic Structures with Vias Having Different Dimensions	发明	US8816218B2	2012.05.29	发行人	2032.12.05	原始取得
5.	Multilayer Electronic Structure with Integral Stepped Stacked Structures	发明	US9269593B2	2012.05.29	发行人	2034.12.25	原始取得
6.	Multilayer Electronic Structures with Integral Vias Extending in In-Plane Direction	发明	US9440135B2	2012.05.29	发行人	2032.12.27	原始取得
7.	Multilayer Electronic Structure with through Thickness Coaxial Structures	发明	US9185793B2	2012.05.30	发行人	2032.10.10	原始取得
8.	Multilayer Electronic Structure with Novel Transmission Lines	发明	US9312593B2	2012.05.30	发行人	2032.12.29	原始取得
9.	Multilayer Electronic Support Structure with Cofabricated Metal Core	发明	US8987602B2	2012.06.14	发行人	2033.01.02	原始取得
10.	Multilayer Electronic Structure with Stepped Holes	发明	US9161461B2	2012.06.14	发行人	2033.03.23	原始取得
11.	Alignment between Layers of Multilayer Electronic Support Structures	发明	US9137905B2	2012.06.25	发行人	2032.07.02	原始取得
12.	Multilayer electronic support structure with integral constructional elements	发明	US9615447B2	2012.07.23	发行人	2032.07.23	原始取得
13.	Method of Fabrication, A Multilayer Electronic Structure and Structures in Accordance with the Method	发明	US8997342B2	2012.10.15	发行人	2033.01.17	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
14.	Single Layer Coreless Substrate	发明	US8866286B2	2012.12.13	发行人	2032.12.13	原始取得
15.	Terminations and Couplings between chips and substrates	发明	US9049791B2	2013.06.07	发行人	2033.07.03	原始取得
16.	Thin Film Capacitors Embedded in Polymer Dielectric	发明	US9349788B2	2013.08.08	发行人	2033.11.05	原始取得
17.	Multilayer Electronic Structures with Embedded Filters	发明	US10014843B2	2013.08.08	发行人	2033.08.08	原始取得
18.	Composite electronic structure with partially exposed and protruding copper termination posts	发明	US9642261B2	2014.01.24	发行人	2034.09.04	原始取得
19.	Method for Fabricating Embedded Chips	发明	US9240392B2	2014.04.09	发行人	2034.06.20	原始取得
20.	Single Layer Coreless Substrate	发明	US8945994B2	2014.09.15	发行人	2032.12.13	原始取得
21.	Polymer frame for a chip, such that the frame comprises at least one via in series with a capacitor	发明	US10446335B2	2014.11.27	发行人	2035.06.24	原始取得
22.	Method of Fabricating a Polymer Frame with a Rectangular Array of Cavities	发明	US9554469B2	2014.12.05	发行人	2034.12.13	原始取得
23.	Film Bulk Acoustic Resonator FILTER	发明	US9374059B1	2015.01.06	发行人	2035.01.07	原始取得
24.	Chip Package	发明	US9779940B2	2015.07.01	发行人	2035.07.01	原始取得
25.	Chip Package	发明	US9589920B2	2015.08.26	发行人	2035.07.01	原始取得
26.	Terminations	发明	US9673063B2	2015.10.26	发行人	2035.10.26	原始取得
27.	Embedded Packages	发明	US9911700B2	2016.01.26	发行人	2036.01.26	原始取得
28.	Interposer Frame with Polymer Matrix and Methods of Fabrication	发明	US9949373B2	2017.01.18	发行人	2034.04.09	原始取得
29.	Substrates with Ultra Fine Pitch Flip Chip Bumps	发明	US10779417B2	2017.06.14	发行人	2035.05.02	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
30.	Multilayer Electronic Structures with Embedded Filters	发明	US10236854B2	2018.04.11	发行人	2033.08.08	原始取得
31.	Heat dissipation-electromagnetic shielding embedded packaging structure, manufacturing method thereof, and substrate	发明	US12074115B2	2020.07.24	发行人	2041.11.19	原始取得
32.	Embedded packaging method capable of realizing heat dissipation	发明	US11114310B1	2020.09.21	发行人	2040.09.21	原始取得
33.	Package substrate and manufacturing method thereof	发明	US11515258B2	2020.09.21	发行人	2040.10.24	原始取得
34.	Support frame structure and manufacturing method thereof	发明	US11569177B2	2020.09.22	发行人	2041.05.05	原始取得
35.	Package structure of integrated passive device and manufacturing method thereof, and substrate	发明	US11342273B2	2020.09.23	发行人	2040.09.23	原始取得
36.	Method for manufacturing coreless substrate	发明	US11399440B2	2020.09.30	发行人	2040.09.30	原始取得
37.	Embedded chip package and manufacturing method thereof	发明	US11854920B2	2020.09.30	发行人	2042.01.06	原始取得
38.	Interposer board without feature layer structure and method for manufacturing the same	发明	US11257713B2	2020.10.19	发行人	2040.10.22	原始取得
39.	Method for manufacturing embedded package structure having air resonant cavity	发明	US12040526B2	2021.04.01	发行人	2042.03.26	原始取得
40.	Embedded structure, manufacturing method thereof and substrate	发明	US11942465B2	2021.07.29	发行人	2042.07.13	原始取得
41.	Embedded packaging structure having shielding cavity and manufacturing method thereof	发明	US11450619B2	2021.08.06	发行人	2041.08.06	原始取得
42.	Passive device packaging structure embedded in glass medium and method for manufacturing the same	发明	US11503712B2	2021.08.16	发行人	2041.08.16	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
43.	Circuit prearranged heat dissipation embedded packaging structure and manufacturing method thereof	发明	US12002734B2	2021.8.25	发行人	2042.07.30	原始取得
44.	Cavity substrate having directional optoelectronic transmission channel and manufacturing method thereof	发明	US11579362B2	2021.09.01	发行人	2041.09.01	原始取得
45.	Connector for implementing multi-faceted interconnection	发明	US11682621B2	2021.09.01	发行人	2041.09.01	原始取得
46.	Substrate manufacturing method for realizing three-dimensional packaging	发明	US11961743B2	2021.12.08	发行人	2042.12.12	原始取得
47.	Packaging structure with antenna and manufacturing method thereof	发明	US11984414B2	2022.01.26	发行人	2042.09.24	原始取得
48.	Multi-device graded embedding package substrate and manufacturing method thereof	发明	US12230581B2	2022.05.11	发行人	2043.07.18	原始取得
49.	Cyclic cooling embedded packaging substrate and manufacturing method thereof	发明	US12300576B2	2022.05.22	发行人	2043.05.02	原始取得
50.	Temporary carrier and method for manufacturing coreless substrate thereby	发明	US12302508B2	2022.05.31	发行人	2041.03.02	原始取得
51.	Hybrid embedded packaging structure and manufacturing method thereof	发明	US12278227B2	2022.06.17	发行人	2043.08.29	原始取得
52.	Conductive substrate and carrier plate wiring structure with filtering function, and manufacturing method of same	发明	US12279377B2	2022.09.29	发行人	2043.08.24	原始取得
53.	Structure for embedding and packaging multiple devices by layer and method for manufacturing same	发明	US11903133B2	2022.09.29	发行人	2042.09.29	原始取得
54.	Package substrate	发明	US11769733B2	2022.10.28	发行人	2040.09.21	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
55.	Cavity substrate having directional optoelectronic transmission channel and manufacturing method thereof	发明	US11822121B2	2023.01.06	发行人	2041.09.09	原始取得
56.	Connector for implementing multi-faceted interconnection	发明	US12040272B2	2023.05.04	发行人	2041.09.01	原始取得
57.	Embedded chip package and manufacturing method thereof	发明	US12148676B2	2023.11.14	发行人	2040.05.12	原始取得
58.	Fabrication method for package structure	发明	US12300511B1	2025.01.15	发行人、电子科技大学	2045.01.15	原始取得
59.	Embedded packaging structure and manufacturing method thereof	发明	US12400967B2	2021.03.19	南通越亚	2041.11.08	原始取得
60.	Capacitor and inductor embedded structure and manufacturing method therefor, and substrate	发明	US12402414B2	2020.07.24	发行人	2040.09.28	原始取得
61.	Support frame structure and manufacturing method thereof	发明	US12412843B2	2023.01.19	发行人	2044.05.06	原始取得
62.	Inductor-integrating embedded support frame and substrate, and manufacturing method thereof	发明	US12418988B2	2022.03.01	发行人	2044.04.14	原始取得
63.	Substrate embedded with integrated inductor and manufacturing method thereof	发明	US12451447B2	2023.02.27	发行人	2042.09.04	原始取得
64.	Package substrate manufacturing method	发明	US12463055B2	2021.07.09	发行人、安世有限公司	2043.02.10	原始取得
65.	Embedded packaging structure and method for manufacturing the same	发明	US12476230B2	2021.08.04	发行人	2041.11.08	原始取得
以色列							
1.	Coreless cavity substrates for chip packaging and their fabrication	发明	IL175011	2006.04.20	发行人	2026.04.20	继受取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
日本							
1.	Novel Integrated Circuit Support Structures and their Fabrication	发明	JP5290761B2	2006.10.15	发行人	2026.10.15	继受取得
2.	Advanced Multilayered Coreless Support Structure and their Fabrication	发明	JP5309311B2	2007.02.28	发行人	2027.02.28	继受取得
3.	Multilayer Electronic Structure with Stepped Holes	发明	JP6079993B2	2012.09.27	发行人	2032.09.27	原始取得
4.	Multilayer Electronic Support Structure with Integral Metal Core	发明	JP6079992B2	2012.09.27	发行人	2032.09.27	原始取得
5.	Multilayer Electronic Structures with through Thickness Coaxial Structures	发明	JP6142980B2	2012.09.27	发行人	2032.09.27	原始取得
6.	Alignment between Layers of Multilayer Electronic Support Structures	发明	JP6264597B2	2012.09.27	发行人	2032.09.27	原始取得
7.	Multilayer electronic support structure with integral constructional elements	发明	JP6213760B2	2012.09.27	发行人	2032.09.27	原始取得
8.	Multilayer Electronic Structures with Integral Vias Extending in In-Plane Direction	发明	JP6459107B2	2012.09.27	发行人	2032.09.27	原始取得
9.	Single Layer Coreless Substrate	发明	JP6393878B2	2013.03.29	发行人	2033.03.29	原始取得
10.	Multilayer Electronic Structures with Embedded Filters	发明	JP6357714B2	2013.10.23	发行人	2033.10.23	原始取得
11.	Thin film capacitor embed in polymer dielectric and manufacturing method of capacitor	发明	JP6296331B2	2013.10.25	发行人	2033.10.25	原始取得
12.	Substrates with Ultra Fine Pitch Flip Chip Bumps	发明	JP6489460B2	2014.03.12	发行人	2034.03.12	原始取得
13.	Substrates with Protruding Copper Termination Posts	发明	JP6590179B2	2014.03.12	发行人	2034.03.12	原始取得
14.	Method for Embedded Chips	发明	JP6090295B2	2014.12.10	发行人	2034.12.10	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
15.	Polymer frame for a chip, such that the frame comprises at least one via in series with a capacitor	发明	JP6695066B2	2015.02.26	发行人	2035.02.26	原始取得
16.	Chip package and method for manufacturing chip package	发明	JP6797521B2	2015.10.19	发行人	2035.10.19	原始取得
17.	Manufacturing method of heat dissipation and electromagnetic shielding embedded packaging structure	发明	JP7236549B2	2020.07.24	发行人	2040.07.24	原始取得
18.	Buried structure of capacitor and inductor, its manufacturing method and substrate	发明	JP7450061B2	2020.07.24	发行人	2040.07.24	原始取得
19.	Multilayer substrate and manufacturing method thereof	发明	JP7450063B2	2020.07.24	发行人	2040.07.24	原始取得
20.	Package substrate and manufacturing method thereof	发明	JP7038169B2	2020.09.10	发行人	2040.09.10	原始取得
21.	Supporting frame structure and manufacturing method thereof	发明	JP7105284B2	2020.09.10	发行人	2040.09.10	原始取得
22.	Heat dissipation embedded packaging structure	实用新型	JP3229456U	2020.09.11	发行人	2030.09.11	原始取得
23.	Heat dissipation embedded packaging method	发明	JP7047034B2	2020.09.11	发行人	2040.09.11	原始取得
24.	Integrated passive device packaging structure, manufacturing method thereof and substrate	发明	JP7058310B2	2020.09.11	发行人	2040.09.11	原始取得
25.	Manufacture method of embedded package structure with air resonant cavity	发明	JP7393378B2	2021.03.30	发行人	2041.03.30	原始取得
26.	Relay substrate without feature lay structure and manufacturing method thereof	发明	JP7176045B2	2021.06.09	发行人	2041.06.09	原始取得
27.	Temporary support plate and method for manufacture coreless substrate using that same	发明	JP7270680B2	2021.06.17	发行人	2041.06.17	原始取得
28.	Method for manufacture packaging substrate	发明	JP7534523B2	2021.07.09	发行人、安世有限	2041.07.09	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
					公司		
29.	Buried packaging structure and manufacturing method thereof	发明	JP7176060B2	2021.07.29	发行人	2041.07.29	原始取得
30.	Passive device structure embedded in glass medium and manufacturing method thereof	发明	JP7221343B2	2021.08.02	发行人	2041.08.02	原始取得
31.	Buried structure, manufacturing method thereof and substrate	发明	JP7257463B2	2021.08.03	发行人	2041.08.03	原始取得
32.	Embed packaging structure with shield room and manufacturing method thereof	发明	JP7158544B2	2021.08.05	发行人	2041.08.05	原始取得
33.	Circuit preset heat dissipation embedded packaging structure and manufacturing method thereof	发明	JP7277521B2	2021.08.10	发行人	2041.08.10	原始取得
34.	Connector for realizing multi-surface interconnection and manufacturing method thereof	发明	JP7266073B2	2021.08.18	发行人	2041.08.18	原始取得
35.	Cham substrate with directional photoelectric transmission path and manufacturing method thereof	发明	JP7423579B2	2021.08.20	发行人	2041.08.20	原始取得
36.	Method for manufacture substrate for realizing three-dimensional package	发明	JP7320045B2	2021.12.07	发行人	2041.12.07	原始取得
37.	Package structure with antenna and manufacturing method thereof	发明	JP7316399B2	2022.01.27	发行人	2042.01.27	原始取得
38.	Embed support frame integrated with inductor, substrate and manufacture method thereof	发明	JP7378525B2	2022.03.03	发行人	2042.03.03	原始取得
39.	Temporary bearing plate, manufacturing method thereof and manufacturing method of packaging substrate	发明	JP7321314B2	2022.03.04	南通越亚	2042.03.04	原始取得
40.	Buried packaging structure and manufacturing method thereof	发明	JP7405888B2	2022.03.11	南通越亚	2042.03.11	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
41.	Vertical packaging module	发明	JP7550812B2	2022.04.27	发行人	2042.04.27	原始取得
42.	Substrate for repeatedly embed and packaging multiple component and manufacturing method thereof	发明	JP7393469B2	2022.05.13	发行人	2042.05.13	原始取得
43.	Embed packaging substrate capable of circulate cooling and manufacturing method thereof	发明	JP7387807B2	2022.05.18	发行人	2042.05.18	原始取得
44.	Hybrid embedded packaging structure and manufacturing method thereof	发明	JP7324905B2	2022.06.20	发行人	2042.06.20	原始取得
45.	Buried packaging structure and manufacturing method thereof	发明	JP7336570B2	2022.06.20	发行人	2042.06.20	原始取得
46.	TMV package structure with signal layer and heat dissipation lay separated and manufacturing method thereof	发明	JP7471352B2	2022.08.04	发行人	2042.08.04	原始取得
47.	Package substrate based on mould for process and manufacturing method thereof	发明	JP7333454B2	2022.09.01	发行人	2042.09.01	原始取得
48.	Double-sided interconnection embedded chip packaging structure and manufacturing method thereof	发明	JP7497407B2	2022.11.14	发行人	2042.11.14	原始取得
49.	Buried inductor structure and manufacturing method thereof	发明	JP7405938B2	2022.11.15	发行人	2042.11.15	原始取得
50.	Package structure with a plurality of components embed in layers and manufacturing method thereof	发明	JP7610563B2	2022.11.16	发行人	2042.11.16	原始取得
51.	Packaging structure and manufacturing method thereof	发明	JP7542587B2	2022.11.17	发行人	2042.11.17	原始取得
52.	Conductive substrate with filter function, wiring structure of carry board and manufacturing method thereof	发明	JP7553530B2	2022.11.18	发行人	2042.11.18	原始取得
53.	Component package substrate structure and	发明	JP7606582B2	2022.12.02	发行人	2042.12.02	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
	manufacturing method thereof						
54.	封装基板的制造方法及封装基板	发明	JP7640593B2	2023.01.05	发行人	2043.01.05	原始取得
55.	Method for manufacture packaging substrate	发明	JP7603729B2	2023.02.20	发行人	2043.02.20	原始取得
56.	Carry plate for manufacturing package substrate, package substrate structure and manufacturing method thereof	发明	JP7428837B2	2023.02.21	发行人	2043.02.21	原始取得
57.	一体型电感嵌入式基板及其制造方法	发明	JP7699618B2	2023.02.28	发行人	2043.02.28	原始取得
58.	Liquid circulating cooling packaging substrate and manufacturing method thereof	发明	JP7497490B2	2023.04.02	发行人	2043.04.02	原始取得
59.	Luminescence sensor structure and manufacturing method thereof	发明	JP7522272B2	2023.07.07	发行人	2043.07.07	原始取得
60.	Method for manufacture package substrate for embedded device	发明	JP7546736B2	2023.08.04	发行人	2043.08.04	原始取得
61.	嵌入式器件封装结构的制造方法	发明	JP7642743B2	2023.08.10	发行人	2043.08.10	原始取得
62.	Embedded flip-chip package substrate and manufacturing method thereof	发明	JP7573702B2	2023.08.14	发行人	2043.08.14	原始取得
63.	Package structure for realizing chip interconnection and manufacture method thereof	发明	JP7607076B2	2023.08.18	珠海越芯	2043.08.18	原始取得
64.	Package structure with chips connected with each other at high density and manufacturing method thereof	发明	JP7603757B2	2023.08.18	发行人	2043.08.18	原始取得
65.	嵌入式元件封装基板的制造方法、封装基板及半导体	发明	JP7622164B2	2023.08.25	发行人	2043.08.25	原始取得
66.	半导体封装结构的制造方法	发明	JP7617993B2	2023.09.13	发行人	2043.09.13	原始取得
67.	塑封腔体结构及其制造方法	发明	JP7659605B2	2023.10.10	发行人	2043.10.10	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
68.	封装基板及其制造方法	发明	JP7659607B2	2023.10.17	发行人	2043.10.17	原始取得
69.	内嵌高效散热模块的封装载板及其制造方法	发明	JP7667888B2	2024.01.09	发行人	2044.01.09	原始取得
70.	嵌入式封装散热结构的制造方法	发明	JP7693858B2	2024.01.09	发行人	2044.01.09	原始取得
71.	有机内插层结构及其制造方法以及封装结构	发明	JP7688190B2	2024.03.13	发行人	2044.03.13	原始取得
72.	Embedded circuit packaging substrate with exposed side and manufacturing method thereof	发明	JP7755337B2	2024.05.07	珠海越芯	2044.05.07	原始取得
73.	Embedded packaging heat dissipation structure, manufacturing method thereof and semiconductor	发明	JP7748445B2	2023.12.28	发行人	2043.12.28	原始取得
74.	Embedded magnet frame, integrated structure and manufacturing method	发明	JP7764517B2	2024.02.29	发行人	2044.2.29	原始取得
75.	Manufacture method of high heat dissipation hybrid substrate and semiconductor structure	发明	JP7764433B2	2023.08.16	发行人	2043.08.16	原始取得
76.	Method for manufacture substrate, embedded substrate and semiconductor	发明	JP7792380B2	2023.08.21	发行人	2043.08.21	原始取得
<b>韩国</b>							
1.	Advanced multilayered coreless support structure and their fabrication	发明	KR100915145B1	2007.03.02	发行人	2027.03.02	继受取得
2.	Novel integrated circuit support structures and the fabrication thereof	发明	KR100983320B1	2008.05.02	发行人	2026.10.15	继受取得
3.	Multilayer Electronic Structures with Integral Vias Extending in In-Plane Direction	发明	KR101409801B1	2012.08.24	发行人	2032.08.24	原始取得
4.	Multilayer Electronic Structures with Vias Having Different Dimensions	发明	KR101385007B1	2012.09.05	发行人	2032.09.05	原始取得
5.	Multilayer Electronic Support Structure with Integral Constructional Elements	发明	KR101489266B1	2012.09.12	发行人	2032.09.12	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
6.	Multilayer Electronic Support Structure with Cofabricated Metal Core	发明	KR101470881B1	2012.09.13	发行人	2032.09.13	原始取得
7.	Multilayer Electronic Structures With Improved Control of Dielectric Thickness	发明	KR101564973B1	2012.12.13	发行人	2032.12.13	原始取得
8.	Single Layer Coreless Substrate	发明	KR101486722B1	2013.03.13	发行人	2033.03.13	原始取得
9.	Thin Film Capacitors Embedded in Polymer Dielectric	发明	KR101542749B1	2013.11.06	发行人	2033.11.06	原始取得
10.	Novel Terminations and Couplings between chips and substrates	发明	KR101575172B1	2013.11.11	发行人	2033.11.11	原始取得
11.	Multilayer Electronic Support Structure with Cofabricated Metal Core (Divisional)	发明	KR101470885B1	2013.11.25	发行人	2032.09.13	原始取得
12.	Multilayer Electronic Structure with Stepped Holes	发明	KR101570055B1	2014.09.19	发行人	2032.09.12	原始取得
13.	Method for Embedded Chips	发明	KR101648365B1	2014.09.29	发行人	2034.09.29	原始取得
14.	Interposer Frame with Polymer Matrix and Methods of Fabrication	发明	KR101670666B1	2014.09.29	发行人	2034.09.29	原始取得
15.	Embedded Chips packaging structure”	发明	KR101680593B1	2014.09.29	发行人	2034.09.29	原始取得
16.	Multilayer composite electronic structure and one side thereof	发明	KR101732471B1	2014.09.29	发行人	2034.09.29	原始取得
17.	A method for attaching a chip to a substrate having an outer layer	发明	KR101659379B1	2014.10.07	发行人	2034.10.07	原始取得
18.	IC support substrate with new transmission line	发明	KR101618046B1	2014.10.13	发行人	2032.09.10	原始取得
19.	Film Bulk Acoustic Resonator FILTER	发明	KR101643128B1	2015.04.15	发行人	2035.04.15	原始取得
20.	Method for Fabricating Film Bulk Acoustic Resonator Filters	发明	KR101730335B1	2015.04.15	发行人	2035.04.15	原始取得
21.	Chip Package	发明	KR101713643B1	2015.09.04	发行人	2035.09.04	原始取得
22.	Multilayer electronic support structure with	发明	KR101679619B1	2015.10.23	发行人	2033.11.20	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
	integral constructional elements						
23.	Multilayer Electronic Structures with Embedded Filters	发明	KR101701737B1	2016.02.15	发行人	2033.11.06	原始取得
24.	A method of attaching a chip to a substrate having an outer layer	发明	KR101832717B1	2016.05.02	发行人	2034.10.07	原始取得
25.	Improved Chip Package	发明	KR101842426B1	2016.08.25	发行人	2036.08.25	原始取得
26.	Staggered frame with named polymer matrix	发明	KR101770148B1	2016.09.21	发行人	2036.09.21	原始取得
27.	Chip Package	发明	KR101730344B1	2016.10.18	发行人	2035.09.04	原始取得
28.	Multilayer electronic support structure with integral constructional elements	发明	KR101751232B1	2016.10.18	发行人	2035.10.23	原始取得
29.	Novel Embedded Packages	发明	KR101912868B1	2016.11.21	发行人	2036.11.21	原始取得
30.	Novel Embedded Packages	发明	KR101925372B1	2018.05.28	发行人	2036.11.21	原始取得
31.	电容器和电感器填埋结构的制作方法	发明	KR102806157B1	2020.07.24	发行人	2040.07.24	原始取得
32.	一种具有空气谐振腔的嵌埋封装结构的制造方法	发明	KR102687755B1	2021.04.23	发行人	2041.04.23	原始取得
33.	一种无特征层结构的转接载板及其制造方法	发明	KR102576548B1	2021.05.11	发行人	2041.05.11	原始取得
34.	一种散热嵌埋封装方法	发明	KR102507887B1	2021.06.07	发行人	2041.06.07	原始取得
35.	支撑框架结构及其制作方法	发明	KR102566362B1	2021.06.07	发行人	2041.06.07	原始取得
36.	一种临时承载板及使用其制造无芯基板的方法	发明	KR102603165B1	2021.06.07	发行人	2041.06.07	原始取得
37.	包装基板制作方法	发明	KR102786330B1	2021.07.09	发行人、安世有限公司	2041.07.09	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
38.	一种嵌入式封装结构及其制造方法	发明	KR102531470B1	2021.07.28	发行人	2041.07.28	原始取得
39.	一种实现多面互连的连接器及其制造方法	发明	KR102595247B1	2021.07.28	发行人	2041.07.28	原始取得
40.	一种嵌埋在玻璃介质中的无源器件结构及其制造方法	发明	KR102657985B1	2021.07.28	发行人	2041.07.28	原始取得
41.	电路预放置散热集成封装结构及其制造方法	发明	KR102772105B1	2021.07.28	发行人	2041.07.28	原始取得
42.	散热兼电磁屏蔽嵌埋封装结构及其制作方法和基板	发明	KR102566363B1	2021.07.29	发行人	2040.07.24	原始取得
43.	一种嵌埋结构及制备方法、基板	发明	KR102553470B1	2021.08.04	发行人	2041.08.04	原始取得
44.	一种具有屏蔽腔的嵌入式封装结构及其制造方法	发明	KR102524298B1	2021.08.06	发行人	2041.08.06	原始取得
45.	一种具有定向光电传输通道的空腔基板及其制造方法	发明	KR102586694B1	2021.08.19	发行人	2041.08.19	原始取得
46.	实现立体封装的基板制作方法	发明	KR102623492B1	2021.12.06	发行人	2041.12.06	原始取得
47.	具有天线的半导体封装结构的制作方法	发明	KR102811697B1	2022.01.28	发行人	2042.01.28	原始取得
48.	集成电感的嵌埋支撑框架、基板及其制作方法	发明	KR102601066B1	2022.03.02	发行人	2042.03.02	原始取得
49.	临时载板及其制造方法以及封装基板的制造方法	发明	KR102750854B1	2022.03.03	发行人	2042.03.03	原始取得
50.	一种嵌埋封装结构及其制造方法	发明	KR102643331B1	2022.03.07	南通越亚	2042.03.07	原始取得
51.	可润湿侧面的封装结构与其制作方法及垂直封装模块	发明	KR102742805B1	2022.04.21	发行人	2042.04.21	原始取得
52.	一种多器件分次嵌埋封装基板及其制造方法	发明	KR102658337B1	2022.05.10	发行人	2042.05.10	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
53.	循环冷却填埋式封装基板及其制作方法	发明	KR102773117B1	2022.06.03	发行人	2042.06.03	原始取得
54.	埋嵌封装结构及其制作方法	发明	KR102687358B1	2022.06.10	发行人	2042.06.10	原始取得
55.	混合嵌入式封装结构及其制作方法	发明	KR102773072B1	2022.06.16	发行人	2042.06.16	原始取得
56.	信热分离 TMV 封装结构及其制作方法	发明	KR102690031B1	2022.08.08	发行人	2042.08.08	原始取得
57.	基于模压成型工艺的封装基板及其制造方法	发明	KR102774243B1	2022.08.18	发行人	2042.08.18	原始取得
58.	一种双面互联嵌入式芯片封装结构及其制造方法	发明	KR102744170B1	2022.09.01	发行人	2042.09.01	原始取得
59.	多器件分层嵌埋封装结构及其制作方法	发明	KR102746921B1	2022.09.02	发行人	2042.09.02	原始取得
60.	多层基板及其制作方法	发明	KR102742806B1	2022.09.21	发行人	2040.07.24	原始取得
61.	具有滤波功能的导电基板、载体基板布线结构及其制造方法	发明	KR102750855B1	2022.09.30	发行人	2042.09.30	原始取得
62.	封装结构及其制作方法	发明	KR102719490B1	2022.10.11	发行人	2042.10.11	原始取得
63.	嵌埋电感结构及其制造方法	发明	KR102691491B1	2022.11.03	发行人	2042.11.03	原始取得
64.	包装基板制作方法和包装基板	发明	KR102823319B1	2022.12.23	发行人	2042.12.23	原始取得
65.	包装基板制造用载体板、包装基板结构及其制造方法	发明	KR102772096B1	2023.02.20	发行人	2043.02.20	原始取得
66.	一种液体循环冷却封装基板及其制作方法	发明	KR102698203B1	2023.05.02	发行人	2043.05.02	原始取得
67.	一种实现芯片互连封装结构及其制作方法	发明	KR102773071B1	2023.05.19	珠海越芯	2043.05.19	原始取得
68.	一种感光发光传感器结构及其制作方法	发明	KR102691819B1	2023.07.05	发行人	2043.07.05	原始取得
69.	芯片高密度互连封装结构及其制造方法	发明	KR102787799B1	2023.07.14	发行人	2043.07.14	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
70.	带集成元件的封装基板及其制作方法	发明	KR102773070B1	2023.08.02	发行人	2043.08.02	原始取得
71.	高散热混合基板的制作方法及其半导体结构	发明	KR102822175B1	2023.08.28	发行人	2043.08.28	原始取得
72.	带内置元件的封装基板的制作方法、封装基板和半导体	发明	KR102786329B1	2023.09.05	发行人	2043.09.05	原始取得
73.	元件封装基板结构及其制造方法	发明	KR102799737B1	2023.10.13	发行人	2043.10.13	原始取得
74.	封装基板及其制作方法	发明	KR102833690B1	2023.02.14	发行人	2043.02.14	原始取得
75.	塑封空腔结构及其制作方法	发明	KR102832503B1	2023.09.26	发行人	2043.09.26	原始取得
76.	一种嵌埋倒装芯片封装基板结构及其制作方法	发明	KR102841510B1	2022.08.29	发行人	2043.07.12	原始取得
77.	一种基板制作方法、嵌埋基板以及半导体	发明	KR102861646B1	2023.09.19	发行人	2043.09.19	原始取得
78.	一种器件嵌埋封装结构的制造方法	发明	KR102865951B1	2023.07.18	发行人	2043.07.18	原始取得
79.	有机中介层结构及其制作方法和封装结构	发明	KR102888715B1	2024.03.13	发行人	2044.03.13	原始取得
80.	一体电感嵌埋基板及其制作方法	发明	KR102897442B1	2023.03.03	发行人	2044.03.03	原始取得
81.	封装基板及制作方法	发明	KR102904584B1	2023.10.13	发行人	2044.10.13	原始取得
<b>中国台湾</b>							
1.	多层无芯支撑结构的制作方法	发明	I423752	2007.06.05	发行人	2027.06.04	继受取得
2.	具有在平面内方向上延伸的一体化通孔的多层电子结构	发明	I556702	2013.03.06	发行人	2033.03.05	原始取得
3.	具有不同尺寸通孔的多层电子结构	发明	I556700	2013.03.06	发行人	2033.03.05	原始取得
4.	具有阶梯状孔的多层电子结构	发明	I566656	2013.03.06	发行人	2033.03.05	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
5.	多层电子支持结构的层间对准	发明	I580326	2013.3.06	发行人	2033.03.05	原始取得
6.	具有一体化金属芯的多层电子支撑结构	发明	I579989	2013.03.06	发行人	2033.03.05	原始取得
7.	多层电子支撑结构及其制造方法	发明	I579978	2013.03.06	发行人	2033.03.05	原始取得
8.	具有全厚度同轴结构的多层电子结构	发明	I625994	2013.03.06	发行人	2033.03.05	原始取得
9.	具有电介质厚度改进控制的多层电子结构	发明	I603450	2013.05.07	发行人	2033.05.06	原始取得
10.	单层无芯基板	发明	I670814	2013.05.07	发行人	2033.05.06	原始取得
11.	在芯片和基板之间的新型端接和连接	发明	I637672	2014.03.04	发行人	2034.03.03	原始取得
12.	嵌入在聚合物电介质中的薄膜电容器及其制造方法	发明	I667674	2014.03.04	发行人	2034.03.03	原始取得
13.	具有突出的铜端子柱的基板	发明	I639215	2014.08.20	发行人	2034.08.19	原始取得
14.	具有超细间距倒装芯片凸点的基板	发明	I727918	2014.08.20	发行人	2034.08.19	原始取得
15.	嵌入式芯片的制造方法	发明	I625839	2014.09.24	发行人	2034.09.23	原始取得
16.	具有聚合物基质的插件框架及其制造方法	发明	I652864	2014.09.26	发行人	2034.09.25	原始取得
17.	具有与电容器串联的至少一个通孔的芯片用聚合物框架	发明	I689954	2015.11.26	发行人	2035.11.25	原始取得
18.	具有矩形空腔阵列的聚合物框架的制造方法	发明	I658542	2015.12.02	发行人	2035.12.01	原始取得
19.	薄膜体声波共振器滤波器的制造方法	发明	I648948	2015.12.30	发行人	2035.12.29	原始取得
20.	薄膜体声波共振器滤波器	发明	I665868	2016.01.05	发行人	2036.01.04	原始取得
21.	晶片封装	发明	I715567	2016.04.14	发行人	2036.04.13	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
22.	新型嵌入式封装	发明	I640067	2017.01.25	发行人	2037.01.24	原始取得
23.	散热兼电磁屏蔽嵌埋封装结构、制作方法和基板	发明	I723936	2020.08.18	发行人	2040.08.17	原始取得
24.	电容电感嵌埋结构、制作方法和基板	发明	I743951	2020.08.18	发行人	2040.08.17	原始取得
25.	一种散热嵌埋封装结构	实用新型	M608326	2020.08.27	发行人	2030.08.26	原始取得
26.	散热嵌埋封装方法	发明	I728914	2020.09.15	发行人	2040.09.14	原始取得
27.	封装基板及其制作方法	发明	I796595	2020.09.15	发行人	2040.09.14	原始取得
28.	多层基板及其制作方法	发明	I743994	2020.09.16	发行人	2040.09.15	原始取得
29.	支撑框架结构及其制作方法	发明	I749784	2020.09.25	发行人	2040.09.24	原始取得
30.	积体被动装置封装结构制作方法	发明	I797482	2020.09.25	发行人	2040.09.24	原始取得
31.	嵌入式晶片封装及其制造方法	发明	I771970	2021.03.31	发行人	2041.03.30	原始取得
32.	一种无特徵层结构的转接载板及其制造方法	发明	I776448	2021.03.31	发行人	2041.03.30	原始取得
33.	一种具有空气谐振腔的嵌埋封装结构的制造方法	发明	I752857	2021.04.06	发行人	2041.04.05	原始取得
34.	一种临时承载板及使用其制造无芯基板的方法	发明	I819320	2021.06.21	发行人	2041.06.20	原始取得
35.	嵌埋结构的制备方法	发明	I811721	2021.07.02	发行人	2041.07.01	原始取得
36.	一种嵌入式封装结构及其制造方法	发明	I772132	2021.07.30	发行人	2041.07.29	原始取得
37.	一种具有遮罩腔的嵌入式封装结构及其制造方法	发明	I792476	2021.08.05	发行人	2041.08.04	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
38.	一种埋在玻璃介质中的无源器件结构及其制造方法	发明	1772142	2021.08.11	发行人	2041.08.10	原始取得
39.	一种线路预排布散热封装结构及其制造方法	发明	1772152	2021.08.17	发行人	2041.08.16	原始取得
40.	一种实现多面互连的连接器及其制造方法	发明	1772158	2021.08.20	发行人	2041.08.19	原始取得
41.	一种具有定向光电传输通道的空腔基板及其制造方法	发明	1797723	2021.08.20	发行人	2041.08.19	原始取得
42.	实现立体封装的基板制作方法	发明	1800149	2021.12.10	发行人	2041.12.09	原始取得
43.	具有天线的封装结构及其制作方法	发明	1788191	2022.01.13	发行人	2042.01.12	原始取得
44.	集成电感的封装支撑框架的制作方法	发明	1823278	2022.03.02	发行人	2042.03.01	原始取得
45.	临时承载板及其制作方法和封装基板的制造方法	发明	1812037	2022.03.02	南通越亚	2042.03.01	原始取得
46.	一种封装结构及其制造方法	发明	1819506	2022.03.02	南通越亚	2042.03.01	原始取得
47.	可润湿侧面的封装结构与其制作方法及垂直封装模组	发明	1809797	2022.03.31	发行人	2042.03.30	原始取得
48.	循环冷却封装基板及其制作方法	发明	1854222	2022.04.27	发行人	2042.04.26	原始取得
49.	一种多器件分次封装基板及其制造方法	发明	1823387	2022.05.12	发行人	2042.05.11	原始取得
50.	埋嵌封装结构及其制作方法	发明	1812232	2022.05.20	发行人	2042.05.19	原始取得
51.	混合封装结构及其制作方法	发明	1838755	2022.05.26	发行人	2042.05.25	原始取得
52.	信热分离 TMV 封装结构及其制作方法	发明	1858353	2022.07.15	发行人	2042.07.14	原始取得
53.	一种基于模制成型制程的封装基板及其制造方法	发明	1853295	2022.08.23	发行人	2042.08.22	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
54.	多器件分层嵌埋封装结构及其制作方法	发明	1819851	2022.10.13	发行人	2042.10.12	原始取得
55.	具有滤波功能的导通基板、载板布线结构及其制作方法	发明	1833387	2022.10.13	发行人	2042.10.12	原始取得
56.	一种双面互联嵌入式芯片封装结构的制造方法	发明	1878734	2022.10.13	发行人	2042.10.12	原始取得
57.	封装结构及其制作方法	发明	1878735	2022.10.13	发行人	2042.10.12	原始取得
58.	嵌埋电感结构及其制造方法	发明	1853323	2022.10.21	珠海越芯	2042.10.20	原始取得
59.	封装基板制作方法及封装基板	发明	1850839	2022.11.09	发行人	2042.11.08	原始取得
60.	一体电感嵌埋基板及其制作方法	发明	1823768	2023.02.04	发行人	2043.02.03	原始取得
61.	封装基板及其制作方法	发明	1876265	2023.02.04	发行人	2043.02.03	原始取得
62.	用于制备封装基板的承载板、封装基板结构及其制作方法	发明	1853465	2023.02.23	发行人	2043.02.22	原始取得
63.	一种液体回圈冷却封装基板及其制作方法	发明	1861843	2023.04.27	发行人	2043.04.26	原始取得
64.	嵌埋器件封装基板及其制作方法	发明	1840213	2023.05.02	发行人	2043.05.01	原始取得
65.	一种感光发光感测器结构及其制作方法	发明	1861995	2023.07.11	发行人	2043.07.10	原始取得
66.	一种器件嵌埋封装结构的制造方法	发明	1866343	2023.07.19	发行人	2043.07.18	原始取得
67.	一种嵌埋倒装芯片封装基板及其制作方法	发明	1878982	2023.07.19	发行人	2043.07.18	原始取得
68.	半导体封装结构及其制备方法	发明	1870951	2023.08.01	发行人	2043.07.31	原始取得
69.	嵌埋器件封装基板制作方法	发明	1870952	2023.08.01	发行人	2043.07.31	原始取得
70.	封装基板及其制作方法	发明	1866521	2023.10.11	发行人	2043.10.10	原始取得

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
71.	一种元器件封装基板结构及其制作方法	发明	I866522	2023.10.11	发行人	2043.10.10	原始取得
72.	嵌埋封装散热结构及其制作方法以及半导体器件	发明	I865215	2023.12.01	发行人	2043.11.30	原始取得
73.	一种嵌埋封装散热结构及其制作方法以及半导体	发明	I874056	2023.12.20	发行人	2043.12.19	原始取得
74.	嵌埋高效散热模块的封装载板及其制作方法	发明	I883722	2023.12.20	发行人	2043.12.19	原始取得
75.	金属口框芯片嵌埋封装基板及其制作方法	发明	I893704B	2024.03.13	发行人	2044.03.12	原始取得
76.	有机中介层结构及其制作方法和封装结构	发明	I893703B	2024.03.13	发行人	2044.03.12	原始取得
77.	磁性变压器嵌埋方法和结构、电子设备、存储介质	发明	I894019B	2024.10.18	发行人	2044.10.17	原始取得
78.	一种芯片高密度互连封装结构及其制作方法	发明	I893412B	2023.07.19	发行人	2043.07.18	原始取得
79.	嵌埋磁体框架、集成结构及制作方法	发明	I893684B	2024.03.01	发行人	2044.02.29	原始取得
80.	塑封空腔结构及其制作方法	发明	I893476B	2023.10.11	发行人	2043.10.10	原始取得
81.	一种实现芯片互连封装结构及其制作方法	发明	I898205B	2023.04.17	发行人	2043.04.16	原始取得
82.	埋磁器件集成结构及其制作方法	发明	I903439B	2024.03.28	发行人	2044.03.27	原始取得
83.	一种基板制作方法、嵌埋基板以及半导体	发明	I903202B	2023.08.01	发行人	2043.07.31	原始取得
84.	一种高散热混合基板制作方法及半导体结构	发明	I903201B	2023.08.01	发行人	2043.07.31	原始取得
85.	多芯片互连封装结构及其制作方法	发明	I907815B	2023.07.19	发行人	2043.07.18	原始取得
英国							

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	权利人	专利期限	取得方式
1.	Package substrate manufacturing method	发明	GB2611941B	2021.07.09	发行人、安世有限公司	2041.07.09	原始取得